



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0109594
(43) 공개일자 2008년12월17일

(51) Int. Cl.

H01L 51/54 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2008-0022787

(22) 출원일자 2008년03월12일

심사청구일자 없음

(30) 우선권주장

JP-P-2007-00156747 2007년06월13일 일본(JP)

(71) 출원인

후지제록쿠스 가부시끼가이샤

일본 도쿄도 미나토구 아가사카 9 초메 7 반 3 고

(72) 발명자

오쿠다 다이스케

일본국 가나가와켄 아시가라카미군 나카이마치 사카이 430후지제록쿠스 가부시끼가이샤 내

사토 가즈히로

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠 1600 후지제록쿠스가부시끼가이샤 내

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

문기상, 문두현

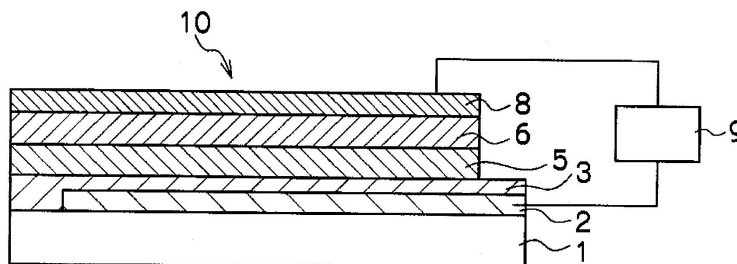
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 유기 전계발광 소자 및 표시 장치

(57) 요약

본 발명은, 적어도 한쪽이 투명 또는 반투명한 한 쌍의 양극 및 음극과, 상기 양극 및 음극의 전극 사이에 끼워진 유기 화합물층을 갖고, 상기 유기 화합물층이, 버퍼층 및 발광층을 적어도 포함하는 2 이상의 층으로 이루어지는 유기 전계발광 소자를 제공한다. 상기 유기 화합물층의 적어도 한 층이 특정의 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1층을 함유한다. 상기 버퍼층이 상기 양극과 접하여 마련되고, 또한 특정의 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료의 적어도 1층을 사용하여 형성되는 가교 화합물을 함유한다. 또한, 기판과, 그 기판 위에 매트릭스 형상으로 배치된 복수의 유기 전계발광 소자와, 유기 전계발광 소자를 구동시키기 위한 구동 수단을 갖는 표시 장치로서, 그 유기 전계발광 소자의 각각이 상기 유기 전계발광 소자인 표시 장치를 제공한다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

니시노 요헤이

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

호리바 고지

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

마시모 기요카즈

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

아가타 다케시

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

이시이 도루

일본국 가나가와켄 아시가라카미군 나카이마치 사
카이 430 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

이마이 아키라

일본국 가나가와켄 아시가라카미군 가이세이마치
우시지마 577-1 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

오자키 다다요시

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

히로세 히데카즈

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

요네야마 히로히토

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

세키 미에코

일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 다케마츠
1600 후지제룻쿠스가부시끼가이샤 내

특허청구의 범위

청구항 1

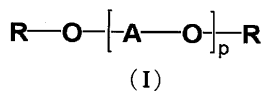
적어도 한쪽이 투명 또는 반투명한 한 쌍의 양극 및 음극과, 상기 양극 및 음극의 전극 사이에 끼워진 유기 화합물층을 갖고,

상기 유기 화합물층이, 버퍼층 및 발광층을 적어도 포함하는 2 이상의 층으로 이루어지고,

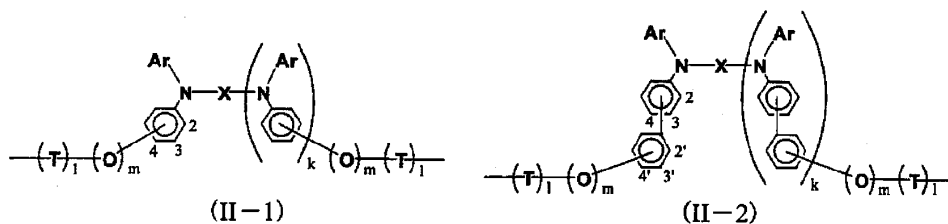
상기 유기 화합물층의 적어도 한 층이, 하기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하고,

상기 버퍼층이 상기 양극과 접하여 마련되고, 또한 하기 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료의 적어도 1종을 사용하여 형성되는 가교 화합물을 함유하는

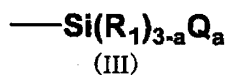
것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.



(일반식 (I) 중, A는 하기 일반식 (II-1) 및 (II-2)로 표시되는 구조에서 선택되는 적어도 1종을 나타내고, R은 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아탈킬기, 아실기, 또는 기 -CONH-R'(여기서, R'는 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아탈킬기를 나타냄)를 나타내고, p는 5~5000의 정수를 나타냄)



(일반식 (II-1) 및 (II-2) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, X는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족기를 나타내고, k, m, l은 각각 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타냄)

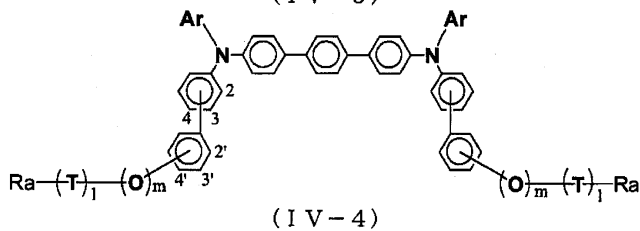
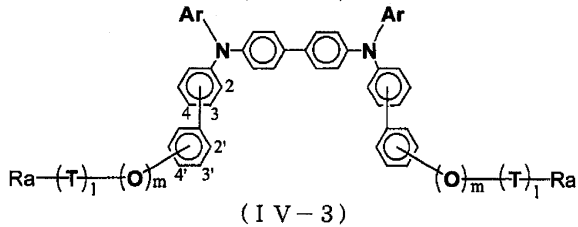
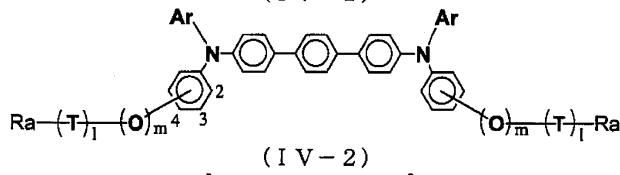
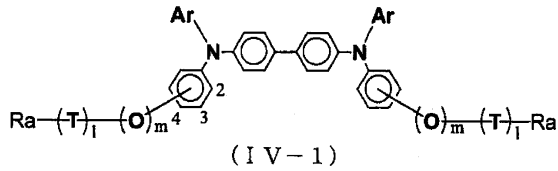


(일반식 (III) 중, R₁은 수소, 알킬기, 또는 치환 또는 미치환의 아릴기를 나타내고, Q는 가수분해성기를 나타내고, a는 1~3의 정수를 나타냄)

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 전하 주입 재료가, 하기 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물의 적어도 1종을 함유하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.



(일반식 (IV-1)~(IV-4) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, Ra는 상기 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기의 적어도 1종을 나타내고, m, l은 각각 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타냄)

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 유기 화합물층이 버퍼층, 발광층, 및 전자 수송층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 포함하고,

상기 발광층 및 상기 전자 수송층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리메테르의 적어도 1종을 함유하는

것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리메테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 발광층, 및 전자 수송층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 구성되고,

상기 정공 수송층, 상기 발광층 및 상기 전자 수송층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리메테르의 적어도 1종을 함유하는

것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 및 발광층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 구성되고,

상기 정공 수송층 및 상기 발광층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는

것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 및 전하 수송능을 갖는 발광층을 이 순서대로 적층하여 구성되고,

상기 전하 수송능을 갖는 발광층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는

것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 전하 수송능을 갖는 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자.

청구항 11

기관과, 그 기관 위에 매트릭스 형상으로 배치된 복수의 유기 전계발광 소자와, 상기 유기 전계발광 소자를 구동시키기 위한 구동 수단을 갖는 표시 장치로서,

상기 유기 전계발광 소자의 각각이 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 기재된 유기 전계발광 소자인 표시 장치.

명세서

발명의 상세한 설명

기술분야

<1> 본 발명은 유기 전계발광 소자 및 표시 장치에 관한 것이다.

배경기술

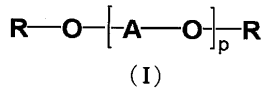
<2> 전계발광 소자는 자발광성의 전(全)고체 소자이며, 시인성이 높고 충격에도 강하기 때문에, 널리 응용이 기대되고 있다.

- <3> 유기 화합물을 사용한 전계발광 소자의 연구는, 최초로 안트라센 등의 단결정을 사용하여 시작했지만, 단결정의 경우, 막두께가 1mm 정도로 두꺼워 100V 이상의 구동 전압이 필요하였다. 그 때문에 증착법에 의한 박막화가 시도되어 있다(Thin Solid Films, Vol. 94, 171(1982) 참조).
- <4> 최근, 정공 수송성 유기 저분자 화합물과 전자 수송능을 갖는 형광성 유기 저분자 화합물의 박막을 진공 증착법에 의해 순차적으로 적층한 기능 분리형 전계발광 소자에서, 10V 정도의 저전압으로 1000cd/m² 이상의 고휘도가 얻어지는 것이 보고되어 있다(Applied Physics Letter, Vol. 51, 913(1987) 참조). 이 연구 보고 이래, 적층형 전계발광 소자의 연구·개발이 활발히 행해지고 있다.
- <5> 이들 적층형 소자는, 전극으로부터 정공과 전자가, 전하 수송성의 유기 화합물로 이루어지는 전하 수송층을 거쳐 정공과 전자의 캐리어 밸런스를 유지하면서 형광성 유기 화합물로 이루어지는 발광층에 주입되어, 발광층 중에 갇힌 정공과 전자가 재결합함으로써 고휘도의 발광을 실현하고 있다.
- <6> 그런데, 정공 수송 재료로서 안정한 아모퍼스 유리 상태가 얻어지는 스타버스트 아민을 사용하거나(예를 들면, 제40회 일본 응용물리학회 연합 강연회 예고집 30a-SZK-14(1993) 등 참조), 폴리포스파젠의 측쇄에 트리페닐 아민을 도입한 폴리머를 사용한(제42회 일본 고분자토론회 예고집 20J 21(1993) 참조) 전계발광 소자가 보고되어 있다.
- <7> 또한, 공정을 단축할 수 있는 단층 구조의 유기 전계발광 소자에 대하여 연구·개발이 진행되어, 폴리(p-페닐렌 비닐렌) 등의 도전성 고분자를 사용한 소자(예를 들면, Nature, Vol. 357, 477(1992) 등 참조)나, 정공 수송성 폴리비닐카르바졸 중에 전자 수송 재료와 형광 색소를 혼입한(제38회 일본 응용물리학회 연합 강연회 예고집 31p-g-12(1991) 참조) 소자가 제안되어 있다.
- <8> 또한, 제작법이라는 관점에서, 제조의 간략화, 가공성, 대면적화, 비용 등의 관점에서 습식에 의한 도포 방식이 검토되어 있으며, 캐스팅법에 의해서도 소자가 얻어짐이 보고되어 있다(제50회 일본 응용물리학회 학술 강연 예고집, 29p-ZP-5(1989), 제51회 일본 응용물리학회 학술 강연 예고집, 28a-PB-7(1990) 참조).
- <9> 또한, 유기 전계발광 소자를 사용한 표시 디바이스는 액정 등의 다른 표시 디바이스와 비교하면 보다 소형화·박형화에 적합하기 때문에, 내부 전원으로 구동하는 휴대형 디바이스에의 이용이 기대되고 있다. 이와 같은 휴대형 디바이스를 실현함에 있어서는, 보다 적은 소비 전력으로 장시간 구동할 수 있는 것이 중요하다.
- <10> 한편, 유기 전계발광 소자의 기본적인 층 구성은 ITO로 이루어지는 투명 전극(양극) 위에 정공 수송층(또는 전하 수송능을 갖는 발광층)이 마련되고, 다른 층이 필요에 따라 더 마련된 구성을 갖는다. 여기서, 상술한 용도에의 대응이나, 더 한층의 에너지 절약화를 도모하는 방법으로서, 투명 전극과 정공 수송층(또는 전하 수송능을 갖는 발광층)의 사이에 버퍼층을 마련하여, 정공 수송층(또는 전하 수송능을 갖는 발광층)에의 전하(정공) 주입 효율을 향상시키는 방법이 알려져 있으며, 이에 의하여 구동 전압을 내릴 수 있다. 이 버퍼층을 구성하는 대표적인 재료로서는, 예를 들면 PEDOT(폴리에틸렌·디옥시티오펜), 스타버스트 아민, CuPc(구리 프탈로시아닌) 등이 알려져 있다.

발명의 내용

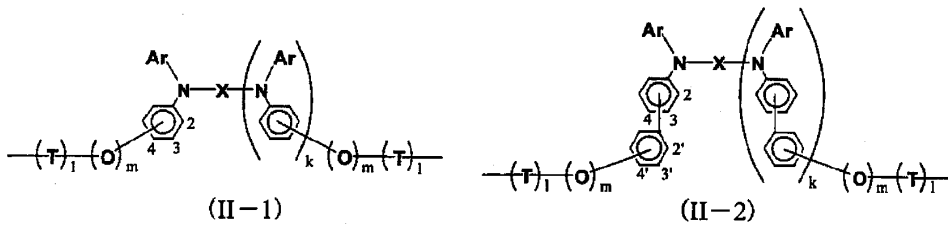
- <11> [개요]
- <12> 본 발명은 높은 휘도를 갖고, 안정성 및 내구성이 뛰어나며, 대면적화가 가능하고 제조가 용이한데다가, 더욱이 제조상의 결함 발생이 적고 또한 소자 성능의 경시적 열화가 적은 유기 전계발광 소자 및 표시 장치를 제공한다.
- <13> 상기 과제는 이하의 수단에 의해 해결된다. 즉, 본 발명은, <1> 적어도 한쪽이 투명 또는 반투명한 한 쌍의 양극 및 음극과, 상기 양극 및 음극의 전극 사이에 끼워진 유기 화합물층을 갖고,
- <14> 상기 유기 화합물층이, 버퍼층 및 발광층을 적어도 포함하는 2 이상의 층으로 이루어지고,
- <15> 상기 유기 화합물층의 적어도 한 층이, 하기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리테트라에틸렌의 적어도 1종을 함유하고,
- <16> 상기 버퍼층이 상기 양극과 접하여 마련되고, 또한 하기 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료의 적어도 1종을 사용하여 형성되는 가교 화합물을 함유하는

<17> 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 소자를 제공한다.



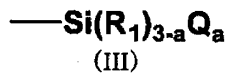
<18>

<19> (일반식 (I) 중, A는 하기 일반식 (II-1) 및 (II-2)로 표시되는 구조에서 선택되는 적어도 1종을 나타내고, R은 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아랄킬기, 아실기, 또는 기 -CONH-R'(여기서, R'는 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아랄킬기를 나타냄)를 나타내고, p는 5~5000의 정수를 나타냄)



<20>

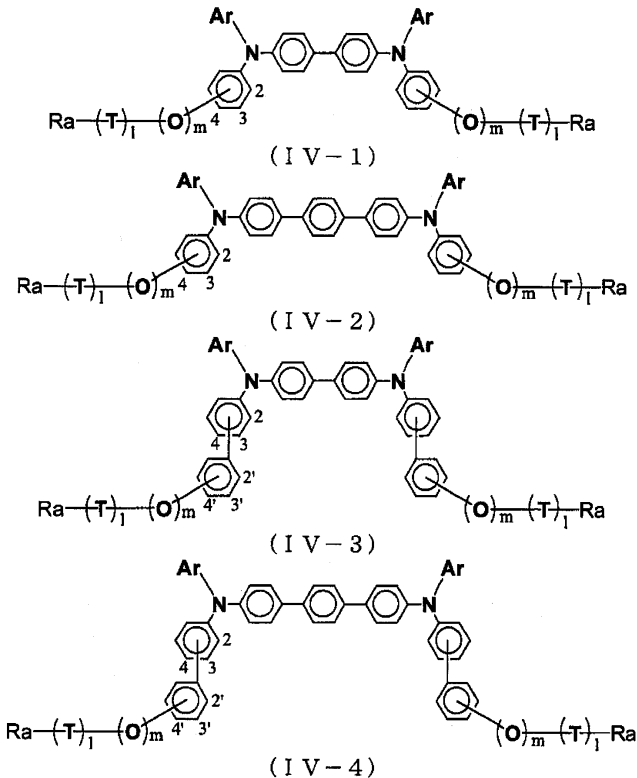
<21> (일반식 (II-1) 및 (II-2) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, X는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족기를 나타내고, k, m, l은 각각 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타냄)



<22>

<23> (일반식 (III) 중, R₁은 수소, 알킬기, 또는 치환 또는 미치환의 아릴기를 나타내고, Q는 가수분해성기를 나타내고, a는 1~3의 정수를 나타냄)

<24> 또한 본 발명은, <2> 상기 전하 주입 재료가, 하기 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물의 적어도 1종을 함유하는 것을 특징으로 하는, <1>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.



<25>

<26> (일반식 (IV-1)~(IV-4) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, Ra는 상기 일반식 (III)으로

표시되는 치환 규소기의 적어도 1종을 나타내고, m, l은 각각 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타냄)

- <27> 또한 본 발명은, <3> 상기 유기 화합물층이 버퍼층, 발광층, 및 전자 수송층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 포함하고,
- <28> 상기 발광층 및 상기 전자 수송층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는
- <29> 것을 특징으로 하는, <1>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <30> 또한 본 발명은, <4> 상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는, <3>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <31> 또한 본 발명은, <5> 상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 발광층, 및 전자 수송층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 구성되고,
- <32> 상기 정공 수송층, 상기 발광층 및 상기 전자 수송층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는
- <33> 것을 특징으로 하는, <1>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <34> 또한 본 발명은, <6> 상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는, <5>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <35> 또한 본 발명은, <7> 상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 및 발광층을 상기 양극 측에서부터 이 순서대로 적층하여 구성되고,
- <36> 상기 정공 수송층 및 상기 발광층의 적어도 한 층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는,
- <37> 것을 특징으로 하는, <1>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <38> 또한 본 발명은, <8> 상기 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는, <7>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <39> 또한 본 발명은, <9> 상기 유기 화합물층이, 적어도 버퍼층, 및 전하 수송능을 갖는 발광층을 이 순서대로 적층하여 구성되고,
- <40> 상기 전하 수송능을 갖는 발광층이, 상기 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하는
- <41> 것을 특징으로 하는, <1>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.
- <42> 또한 본 발명은, <10> 상기 전하 수송능을 갖는 발광층이 상기 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전하 수송성 재료를 함유하는 것을 특징으로 하는, <9>의 유기 전계발광 소자를 제공한다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- <43> 이하, 본 발명의 실시 형태에 대하여 상세히 설명한다.
- <44> 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자는,
- <45> 적어도 한쪽이 투명 또는 반투명(여기서, 투명 또는 반투명이란, 가시광의 투과율이 50% 이상임을 의미함. 이하 동일)한 한 쌍의 양극 및 음극과, 상기 양극 및 음극의 전극 사이에 끼워진 버퍼층 및 유기 화합물층을 갖고,
- <46> 상기 유기 화합물층이, 버퍼층 및 발광층을 적어도 포함하는 2 이상의 층으로 이루어지고,
- <47> 상기 유기 화합물층의 적어도 한 층이, 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르의 적어도 1종을 함유하고,
- <48> 상기 버퍼층이 상기 양극과 접하여 마련되고, 또한 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입

재료의 적어도 1종을 사용하여 형성되는 가교 화합물을 함유하는

- <49> 것을 특징으로 하고 있다.
- <50> 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자는 상기 구성으로 함으로써, 높은 휘도를 갖고, 안정성 및 내구성이 뛰어나며, 대면적화가 가능하고 제조가 용이한데다가, 더욱이 제조상의 결함 발생이 적고 또한 소자 성능의 경시적 열화가 적어진다. 이것은 이하와 같이 검토한 결과에 의한 것이다.
- <51> 우선, 버퍼층을 마련한 유기 전계발광 소자를 제작한 경우, 제조상에서의 각종 결함의 발생이나, 소자 성능의 경시적 열화가 일어나는 원인에 대하여 예의 검토했다. 그리고, 양극 위에 형성된 버퍼층 표면에, 고분자계의 전하 수송성 재료를 사용하여 정공 수송층 또는 전하 수송능을 갖는 발광층(이하, 버퍼층 위에 직접 또는 다른 층을 거쳐 간접적으로 형성되는 층을 「인접층」이라고 약기하는 경우가 있음)을 형성하려고 했을 경우의 문제점에 대하여 조사했다.
- <52> 그 결과, 사용하는 전하 수송성 고분자가 비닐계 골격(예를 들면, PTPDMA(일본 고분자논문집, Vol. 52, 216(1995) 참조)이나 폴리카르보네이트계 골격(예를 들면, Et-TPAPEK(제43회 일본 응용물리학회 연합 강연회 예고집 27a-SY-19, pp. 1126(1996) 참조) 등의 경우인 것에서는, 버퍼층과 인접층의 밀착성이 불충분해져 박리 결함이 발생하거나, 또 편홀이 생성하거나 응집이 발생하는 경우가 있음을 확인했다. 이 결함의 원인으로서는, 버퍼층과 인접층의 계면에서의 친화성의 나쁨이나, 인접층을 구성하는 고분자의 유연성 결여가 고려된다.
- <53> 따라서, 이들의 성막상의 결함 방지라는 관점에서는, 인접층의 형성에 사용하는 전하 수송성 고분자로서는, 유연성이 높은 분자 구조를 갖는 재료를 사용하거나, 또는 상술한 유연성이 낮은 분자 구조를 갖는 재료이더라도 분자 자체의 사이즈를 작게 함(분자량을 작게 함)으로써, 분자의 유연성을 향상시키거나, 인접층 중에서의 분자간의 재배열을 용이하게 함으로써 대응할 수 있다고 생각했다.
- <54> 또한, 소자 성능의 경시적 열화가 발생하는 원인에 대해서도 조사했다. 그 결과, 사용하는 전하 수송성 고분자가 상술한 경우와 마찬가지로 비닐계 골격이나 폴리카르보네이트계 골격의 경우, 시간과 함께 구동 전압이 상승하여 소비 전력을 증가시키고, 더욱이 발광 특성 자체의 저하를 초래해 버리는 경우가 있음을 알았다.
- <55> 이 원인에 대하여 조사한 바, 버퍼층에 함유되는 저분자 성분(예를 들면, 스타버스트 아민이나 CuPc(구리 프탈로시아닌), 또는 PEDOT(폴리에틸렌·디옥시티오펜)과 병용되는 이온성 물질의 상대 이온)이, 소자에의 전계 인가 시에 생기는 줄열 또는 전장(電場)에 의해 시간과 함께 인접층으로 블리딩(스며나옴)함으로써, 인접층 본래의 기능을 발휘할 수 없게 됨을 알았다. 또한, 블리딩의 발생은 버퍼층 중의 저분자 성분이, 비닐계 골격이나 폴리카르보네이트계 골격의 전하 수송성 고분자를 사용하여 형성된 인접층 내로 침투하기 쉬움, 바꿔 말하면, 인접층 중의 전하 수송성 고분자 사이의 극간(隙間)이 크고/용이하게 형성되기 쉬움을 의미하고 있다.
- <56> 그 때문에, 블리딩을 억제하기 위해서는, 저분자 성분의 인접층으로의 블리딩을 방지할 수 있도록, 치밀하고 내열성이 높은 인접층을 형성함이 중요하다고 생각했다. 이 경우, 저분자 성분의 블리딩을 촉진하는 분자간의 극간을, 인접층의 형성 시에 극간 없이 메우는 것, 및 일단 형성된 인접층 내에서, 열에 의해 분자간의 상대적인 이동이 발생하여 분자간의 극간을 발생시키지 않는 것이 블리딩의 방지에는 중요하다.
- <57> 따라서, 블리딩 억제의 관점에서, 인접층을 형성하는 전하 수송성 고분자로서는, 내열성(유리 전이 온도)이 높고, 유연성과 치밀성을 겸비한 분자 구조를 갖는 재료를 사용함이 필요하다. 그러나, 이 조건은 성막상의 결함을 억제하는 선택지의 하나인, 유연성이 낮은 분자 구조를 갖는 분자량이 작은 전하 수송성 고분자의 이용과 상반 관계에 있다.
- <58> 또한, 발본적인 블리딩 억제를 위해서는, 버퍼층에 사용하는 전하 주입 재료나 그 병용 성분으로서, 블리딩의 원인이 되는 저분자 성분을 함유하지 않는 재료를 이용하는 것도 고려된다.
- <59> 더하여, 전하 수송성 고분자는 유기 전계발광 소자의 중요한 발광 특성을 좌우하는 전하 이동도를 확보하기 위하여, 분자 중에 전하 이동을 담당하는 호핑 사이트(hopping site)를 어느 일정수 이상 갖고 있을 필요가 있다. 즉, 바꿔 말하면, 필연적으로 어느 정도 이상의 분자 사이즈(분자량)가 필요하다. 그러나, 이 조건도 블리딩 억제의 경우와 마찬가지로, 성막상의 결함을 억제하는 선택지의 하나인, 유연성이 낮은 분자 구조를 갖는 분자량이 작은 전하 수송성 고분자의 이용과 상반 관계에 있다.
- <60> 즉, 분자 구조의 유연성이 결여된 전하 수송성 고분자에서는, 본질적으로 블리딩을 억제하기 위하여 치밀한 인접층을 형성함이 곤란한 한편, 블리딩을 억제하기 위하여, 분자량을 작게 하면 내열성 저하에 의한 블리딩의 촉진이나, 소자의 기본적 특성에 따른 전하 이동도 자체의 저하를 초래한다는 근본적으로 해결하기 어려운 딜레마

를 안고 있다.

- <61> 그 때문에, 버퍼층을 마련한 유기 전계발광 소자를 얻음에 있어, 발광 특성이라는 기본적인 특성의 확보에 더하여, 제조성이나 장기의 사용에 견딜 수 있는 실용성도 고려한 경우에는, 인접층의 형성에 사용하는 전하 수송성 고분자로서는, 버퍼층으로서 블리딩의 원인이 되는 재료를 사용할 경우에는, 충분한 전하 이동도를 갖고 있을 뿐만 아니라, 유연성이 높고 치밀함을 겸비한 분자 구조 및 높은 내열성도 겸비한 재료를 사용함이 중요하다고 생각했다.
- <62> 이 점에서, 상기 전하 수송성 폴리에테르는 하기에 나타낸 특징을 갖는다.
- <63> (1) 기능 부위 사이를 연결하는 에테르 결합이 강고한 결합이며 또한 변형에 대하여 내성을 갖는다.
- <64> (2) 에테르 결합이 비극성 결합이며, 게다가 주쇄형이므로 폴리머 중에 차지하는 기능 부위의 비율이 많기 때문에 전하 수송에 대한 영향이 측쇄형에 비하여 작다. 따라서, 전하 수송성이 뛰어나다.
- <65> (3) 에테르 결합이 굴곡성이 뛰어나기 때문에, 치밀하고 균일한 밀착성이 뛰어난 박막을 형성할 수 있다.
- <66> 이상에 나타낸 점에서, 기능 부위를 주쇄 중에 도입한 폴리에테르를 전하 수송성 고분자로서 사용하는 것은 적합하다.
- <67> 또한, 발본적으로 블리딩을 억제하기 위해서는, 버퍼층을, 블리딩의 원인이 되는 저분자 성분의 이용이 기본적으로 필요 없는 성분을 사용하여 형성함이 필요하다고 생각하여, 예를 들면 전하 주입 재료가 저분자를 함유한 상태로 형성되는 것이 아니고, 강고한 결합에 의해 망상 구조(네트워크)를 형성시키는 재료를 사용함이 고려된다.
- <68> 망상 구조(네트워크)를 형성시키는 재료로서, 3차원 가교성 재료를 들 수 있지만, 전하 주입 재료에 도입한 구체적인 예로서는, 예를 들면
 - <69> (A) 특정한 반복 구조를 갖고 말단에 수산기 또는 카르복시기를 갖는 전하 수송성 폴리에테르, 또는 폴리카르보네이트 등을, 1분자 중에 3관능 이상의 이소시아네이트기 또는 에폭시기 등을 갖는 가교제를 사용하여 가교시킨 타입(일본 특개평8-176293호 공보, 특개평8-208820호 공보, 특개평8-253568호 공보, 특개평9-110974호 공보 등 참조)
 - <70> (B) 말단에 열 또는 광경화성 관능기를 갖는 전하 수송제를 가교시킨 타입(일본 특개 2000-147804호 공보, 특개 2000-147813호 공보 등 참조)
 - <71> (C) 옥세탄을 갖는 전하 수송제를 광가교시킨 타입(Macromol. Rapid Commun., 20, pp. 224-228(1999) 참조)
 - <72> (D) 말단에 알콕시실릴기를 갖는 전하 수송제를 가열 가교시킨 타입(Adv. Mater., Vol. 11, No. 2, pp. 107-112(1999), Adv. Mater., Vol. 11, No. 9, pp. 730-734(1999), 일본 특개평9-124665호 공보, 특개평11-38656호 공보 등 참조)
- <73> 등 각종의 것을 들 수 있다.
- <74> 이 점에서, 상기 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료를 사용하여, 3차원 가교 처리하여 형성되는 버퍼층은, 후술하는 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 가지므로 서로 가교 반응을 일으켜, 3차원 -Si-O-Si- 결합, 즉 효과적인 무기 유리질 망상 구조(네트워크)를 형성할 수 있으며, 아울러 무기 재료를 주체로 하는 기관과의 접착성이 뛰어나다. 즉, 3차원 가교에 의해, 강고한 결합을 형성하고 또한 무기 재료를 주체로 형성되는 양극과의 밀착성이 뛰어나므로, 유기 전계발광 소자의 특성을 향상시킬 수 있다는 관점에서 좋다고 생각된다. 더하여, 후술하는 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 전하 주입 재료를 사용하면, 이것에 의한 3차원 가교 구조 중에 방향족 아민 구조 단위가 형성·도입되어, 전자 수용성 재료를 병용함에 의한 도핑 효과를 이용한 도전성의 향상을 필요로 하지 않고 중성 상태에서 양호한 주입성을 나타내므로, 병용 성분으로서 전자 수용성 재료를 혼합하는 경우와 달리, 인접하는 유기 화합물층으로의 블리딩을 해소할 수 있다.
- <75> 즉, 상기 버퍼층을 사용함으로써 전하 주입 재료가 인접층으로 블리딩하지 않고 양극과의 밀착성이 뛰어나며, 아울러 상기 전하 수송성 폴리에테르를 사용하여 인접하는 유기층을 형성함으로써 유기 EL 소자로서 요구되는 충분한 전하 이동도를 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 편흡이나 응집 등의 결합이 적은데다가 버퍼층과의 밀착성이 뛰어나고, 그 결과 장수명이며 고성능의 유기 EL 소자를 구축할 수 있다.
- <76> 그리고, 소자 제작 프로세스에서, 유기 화합물층을 구성하는 재료 전부에 고분자 화합물을 사용함으로써, 유기

화합물층의 형성을 모두 습식에 의한 도포 방식으로 행할 수 있어, 제조의 간략화, 가공성, 대면적화, 비용 등의 관점에서 매우 유리해지는데, 상기 전하 수송성 폴리에테르에 의해서는, 발광층으로서 사용하는 발광 재료의 종류에 관계없이 안정한 소자 특성을 발현할 수 있다.

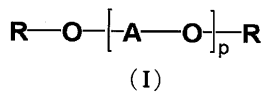
<77> 이상의 결과, 본 실시 형태에 따른 유기 EL 소자는 높은 휘도를 갖고, 안정성 및 내구성이 뛰어나며, 대면적화가 가능하고 제조가 용이한데다가, 더욱이 제조상의 결함 발생이 적고 또한 소자 성능의 경시적 열화가 적어진다.

<78> 이하, 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르에 대하여 설명한다.

<79> 또한, 전하 수송성 폴리에테르는 타종에 비하여, 결합 부위가 강고하며, 또한 굴곡성이 뛰어나기 때문에, 분자 구조의 유연성과 높은 내열성(유리 전이 온도)을 겸비하고 있으므로, 박막 형성능이 뛰어나고, 습식 제막 프로세스의 채용이 용이함과 동시에, 내구성이 뛰어난 재료이다.

<80> 또한, 전하 수송성 폴리에테르는 후술하는 바와 같이, 그 분자 구조를 적절히 선택함으로써 정공 수송능, 전자 수송능의 어느 기능도 부여할 수 있다. 이 때문에, 목적에 따라 정공 수송층, 발광층, 전하 수송층 등의 어느 층으로도 사용할 수 있다.

<81> 전하 수송성 폴리에테르에 있어서 특히 적합한 것은, 정공 수송성을 갖는 폴리에테르(정공 수송성 폴리에테르)이다.

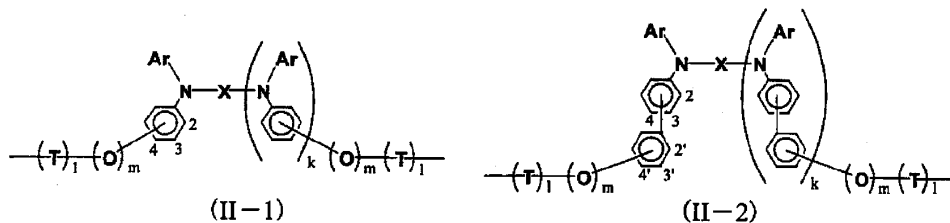


<82>

<83> 단, 일반식 (I) 중, A는 하기 일반식 (II-1) 및 (II-2)로 표시되는 구조에서 선택되는 적어도 1종을 나타내고, R은 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아릴알킬기, 아실기, 또는 기 -CONH-R' (여기서, R'는 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아릴알킬기를 나타냄)를 나타내고, p는 5~5000의 정수를 나타낸다.

<84> 일반식 (I) 중, A는 하기 일반식 (II-1) 및 (II-2)로 표시되는 구조에서 선택된 적어도 1종을 나타내고, 하나의 폴리머 중에 2종류 이상의 구조 A가 포함되어도 된다.

<85> 우선, 하기 일반식 (II-1) 및 (II-2)로 표시되는 구조에 대하여 상세히 설명한다.



<86>

<87> 단, 일반식 (II-1) 및 (I-2) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, X는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족기를 나타내고, k, m, l은 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타낸다.

<88> 일반식 (II-1) 및 (II-2) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타낸다.

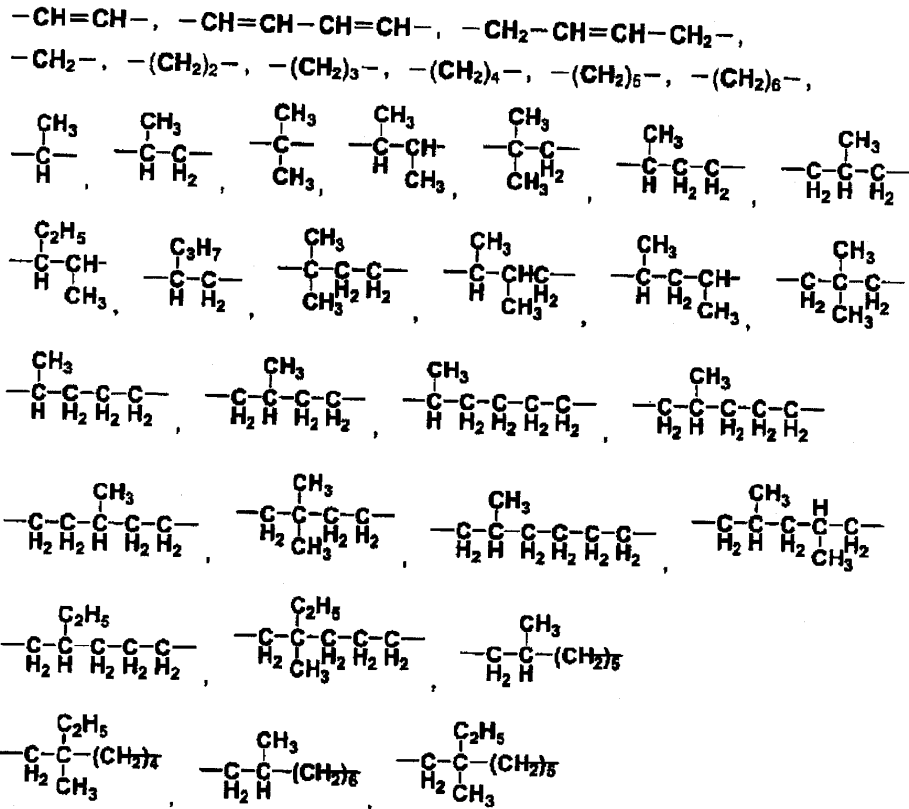
<89> 구체적으로는, Ar은 치환 또는 미치환의 페닐기, 치환 또는 미치환의 방향환수 2~10의 1가의 다핵 방향족 탄화수소, 치환 또는 미치환의 방향환수 2~10의 1가의 축합환 방향족 탄화수소, 치환 또는 미치환의 1가의 방향족 복소환, 또는 적어도 1종의 방향족 복소환을 포함하는 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타낸다.

<90> 여기서, 일반식 (II-1) 및 (II-2) 중에서, Ar을 나타내는 구조로서 선택되는 다핵 방향족 탄화수소 및 축합환 방향족 탄화수소를 구성하는 방향환수는 특별히 한정되지 않지만, 방향환수가 2~5인 것이 바람직하고, 축합환 방향족 탄화수소에 서는, 전 축합환 방향족 탄화수소가 바람직하다. 또한, 그 다핵 방향족 탄화수소 및 축합환 방향족 탄화수소란, 본 실시 형태에서는, 구체적으로는 이하에 정의되는 다환식 방향족임을 의미한다.

<91> 즉, 「다핵 방향족 탄화수소」란, 탄소와 수소로 구성되는 방향환이 2개 이상 존재하고, 이들 방향환끼리가 탄소-탄소의 단결합에 의해 결합하고 있는 탄화수소 화합물을 나타낸다. 구체적인 예로서는, 비페닐, 터페닐 등

을 들 수 있다.

- <92> 또한 「축합환 방향족 탄화수소」란, 탄소와 수소로 구성되는 방향환이 2개 이상 존재하고, 이들 방향환끼리가, 한 쌍의 인접하여 결합하는 2 이상의 탄소 원자를 공유하고 있는 탄화수소 화합물을 나타낸다. 구체적인 예로서는, 나프탈렌, 안트라센, 페난트렌, 플루오렌 등을 들 수 있다.
- <93> 또한, 「방향족 복소환」이란, 탄소와 수소 이외의 원소도 포함하는 방향환을 나타낸다. 그 환골격을 구성하는 원자수(Nr)는 $Nr = 5$ 및/또는 6이 바람직하게 사용된다. 또한, 환골격을 구성하는 C 이외의 원소(이종 원소)의 종류 및 수는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 S, N, O 등이 바람직하게 사용되며, 상기 환골격 중에는 2종류 이상 및/또는 2개 이상의 이종 원자가 포함되어 있어도 된다. 특히, 5원환 구조를 갖는 복소환으로서, 티오펜, 티오피린 및 푸란 또는 이들의 3위치 및 4위치의 탄소를 질소로 더 치환한 복소환, 피롤 또는 이들의 3위치 및 4위치의 탄소를 질소로 더 치환한 복소환이 바람직하게 사용되며, 6원환 구조를 갖는 복소환으로서, 피리딘이 바람직하게 사용된다.
- <94> 「방향족 복소환을 포함하는 방향족기」란, 골격을 구성하는 원자단 중에, 적어도 1종의 상기 방향족 복소환을 포함하는 결합기를 나타낸다. 이들은 모두가 공역계로 구성된 것, 또는 적어도 일부가 비공역계로 구성된 것의 어느 것이어도 되지만, 전하 수송성이나 발광 효율의 점에서, 모두가 공역계로 구성된 것이 바람직하다.
- <95> 페닐기, 다핵 방향족 탄화수소, 축합환 방향족 탄화수소, 방향족 복소환, 또는 방향족 복소환을 포함하는 방향족기의 치환기로서는, 수소 원자, 알킬기, 알콕시기, 페녹시기, 아릴기, 아랄킬기, 치환 아미노기, 할로젠 원자 등을 들 수 있다.
- <96> 알킬기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기 등을 들 수 있다. 알콕시기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메톡시기, 에톡시기, 프로폭시기, 이소프로폭시기 등을 들 수 있다. 아릴기로서는, 탄소수 6~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 페닐기, 톨루일기 등을 들 수 있다. 아랄킬기로서는, 탄소수 7~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 벤질기, 페네틸기 등을 들 수 있다. 치환 아미노기의 치환기로서는, 알킬기, 아릴기, 아랄킬기 등을 들 수 있고, 구체적인 예는 상술한 바와 같다.
- <97> 일반식 (II-1) 및 (II-2) 중, X는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족기를 나타낸다. 구체적으로는, X는 치환 또는 미치환의 페닐렌기, 또는 치환 또는 미치환의 방향환수 2~10의 2가의 다핵 방향족 탄화수소, 또는 치환 또는 미치환의 방향환수 2~10의 2가의 축합환 방향족 탄화수소, 또는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족 복소환, 또는 적어도 1종의 방향족 복소환을 포함하는 치환 또는 미치환의 2가의 방향족기를 나타낸다.
- <98> 여기서, 「다핵 방향족 탄화수소」, 「축합환 방향족 탄화수소」, 「방향족 복소환」, 「방향족 복소환을 포함하는 방향족기」에 관해서는 상술한 바와 같다.
- <99> 일반식 (II-1) 및 (II-2) 중, k, l, m은 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소, 또는 탄소수 2~10의 2가의 분지쇄상 탄화수소기를 나타내고, 바람직하게는 탄소수 2~6의 2가의 직쇄상 탄화수소기, 또는 탄소수 3~7의 2가의 분지쇄상 탄화수소에서 선택된다. T의 구체적인 구조를 이하에 나타낸다.



<100>

<101> 다음에, 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리에테르에 대하여 상세히 설명한다.

<102> 일반식 (I) 중, R은 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아랄킬기, 아실기, 또는 기 -CONH-R'를 나타낸다.

<103> 알킬기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기 등을 들 수 있다. 아릴기로서는, 탄소수 6~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 페닐기, 톨루일기 등을 들 수 있다. 아랄킬기로서는, 탄소수 7~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 벤질기, 페네틸기 등을 들 수 있다. 또한, 치환 아릴기, 치환 아랄킬기의 치환기로서는, 수소 원자, 알킬기, 알콕시기, 치환 아미노기, 할로젠 원자 등을 들 수 있다.

<104> 아실기로서는, RCO-로 표시되는 각종의 것이면 되고, 특별히 한정되지는 않지만, 바람직하게는 아세틸, 프로피오닐, 말로닐, 벤조일 등을 들 수 있다.

<105> 기 -CONH-R' 중의 R'는 수소 원자, 알킬기, 치환 또는 미치환의 아릴기, 치환 또는 미치환의 아랄킬기를 나타낸다. 기 -CONH-R' 중의 R'는 구체적으로는, 알킬기로서는 직쇄, 또는 분지상의 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 메틸기, 에틸기, 이소프로필기 등이 바람직하다. 아릴기로서는 탄소수 6~20의 것이 바람직하고, 페닐기, 톨루일기 등이 바람직하다.

<106> 아랄킬기란, 아릴기로 치환되어 있는 저급 알킬기를 의미하고, 아릴기로서는 상술한 바와 같으며, 구체적으로는 벤질기, 페네틸에틸기, 페닐프로필기, 나프틸메틸기, 나프틸에틸기 등을 들 수 있다.

<107> 일반식 (I) 중, 중합도를 나타내는 p는 5 이상 5,000 이하의 범위이지만, 바람직하게는 10 이상 1,000 이하의 범위이다.

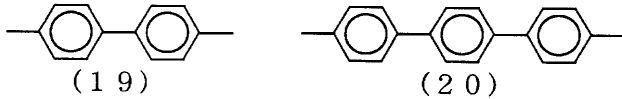
<108> 또한, 전하 수송성 폴리에테르의 중량 평균 분자량 Mw는 5,000 이상 1,000,000 이하의 범위인 것이 바람직하고, 10,000 이상 300,000 이하의 범위인 것이 보다 바람직하다.

<109> 또한, 상기 중량 평균 분자량 Mw는 이하의 방법에 의해 측정할 수 있다.

<110> 중량 평균 분자량의 측정은, 우선 전하 수송성 폴리에테르의 1.0질량% THF(테트라히드로푸란) 용액을 제조하고, 시차 굴절률 검출기(RI, 토소사제, 상품명 : UV-8020)를 사용하고, 겔침투 크로마토그래피(GPC)에 의해, 표준 샘플로서 스티렌 폴리머를 사용하여 행했다.

<111> 이상 설명한 일반식 (I) 및 일반식 (II-1) 및 (II-2)에서, 합성 용이성과 소자 특성을 충족시킬 수 있는 기초 물성을 구비한다는 점에서, 일반식 (I)에서는, R은 메틸기, 에틸기를 나타내고, p는 10~1,000의 정수를 나타내고,

<112> A를 나타내는 일반식 (II-1) 및 (II-2)에서는, Ar은 페닐, 비페닐, 나프탈렌, 9,9'-디메틸플루오렌을 나타내고 (방향환의 치환기로서는, 메틸기, 에틸기, 이소프로필기, tert-부틸기, 메톡시기가 바람직함), X는 하기식 (19)~(20)



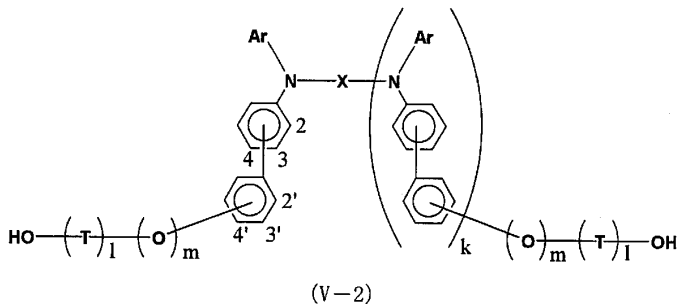
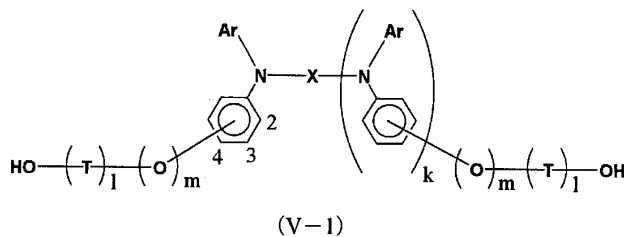
<113>

<114> 을 나타내고, k는 1을, m은 0을, l은 1을 나타내고, T는 메틸렌기 또는 디메틸렌기를 나타내는 것이 적합하다.

<115> 여기서, 일반식 (I)의 전하 수송성 폴리테르의 구체적인 예로서는, 예를 들면 일본 특개 2002-75654호, 특개 2002-313576호, 특개 2004-87395호, 특개 2004-199998호, 특개 2005-235645호 등에 개시되어 있는 것을 들 수 있다.

<116> 다음에, 전하 수송성 폴리테르의 합성 방법에 대하여 설명한다. 전하 수송성 폴리테르는 하기 구조식 (V-1) 또는 (V-2)로 표시되는 전하 수송성 모노머를, 예를 들면 제4판 실험화학강좌 제28권(마루젠(일본), 1992) 등에 기재된 공지의 방법으로 중합시킴으로써 합성할 수 있다.

<117> 또한, 구조식 (V-1) 또는 (V-2) 중, Ar, X, T, k, l, m은 상기 일반식 (II-1) 또는 (II-2)에서의 Ar, X, T, k, l, m과 동일하다.



<118>

<119> 여기서 일반식 (I)로 표시되는 전하 수송성 폴리테르는, 예를 들면 다음과 같이 합성할 수 있다.

<120> <합성법 1>

<121> 전하 수송성 폴리테르의 합성법으로서, 예를 들어 상기 일반식 (V-1) 및 (V-2) 중 2개의 히드록시알킬기를 갖는 전하 수송성 화합물(전하 수송성 모노머)을 가열 탈수 축합하는 방법(합성법 1)을 들 수 있다.

<122> 이 경우, 무용매로 전하 수송성 모노머를 가열 용융하고, 물의 탈리에 의한 중합 반응을 촉진시키기 위하여, 감압하에서 반응시키는 것이 바람직하다.

<123> 또한, 용매를 사용하는 경우에는, 물의 제거를 위하여, 물과 공비하는 용매, 예를 들면 트리클로로에탄, 톨루엔, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 니트로벤젠, 1-클로로나프탈렌 등이 유효하며, 전하 수송성 모노머 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 100당량 이하, 보다 바람직하게는 2당량 이상 50당량 이하의 범위로 사용된다.

<124> 반응 온도는 특별히 한정되지 않지만, 중합 중에 생성되는 물을 제거하기 위하여, 용매의 비점에서 반응시키는 것이 바람직하다. 중합이 진행되지 않는 경우에는, 반응계로부터 용매를 제거하여, 점조(粘稠) 상태에서 가열

교반해도 된다.

<125> <합성법 2>

<126> 전하 수송성 폴리에테르의 다른 합성법으로서는, 예를 들면 산촉매로서 p-톨루엔술포산, 염산, 황산, 트리플루오로아세트산 등의 프로톤산, 또는 염화아연 등의 루이스산을 사용하여 탈수 축합하는 방법(합성법 2)을 들 수 있다. 이 경우, 전하 수송성 모노머 1당량에 대하여, 산촉매를 바람직하게는 1/10,000당량 이상 1/10당량 이하, 보다 바람직하게는 1/1,000당량 이상 1/50당량 이하의 범위로 사용한다.

<127> 중합 중에 생성되는 물을 제거하기 위하여, 물과 공비 가능한 용제를 사용하는 것이 바람직하다. 용제로서는, 예를 들면 톨루엔, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 니트로벤젠, 1-클로로나프탈렌 등이 유효하며, 전하 수송성 모노머 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 100당량 이하, 보다 바람직하게는 2당량 이상 50당량 이하의 범위로 사용된다.

<128> 반응 온도는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 중합 중에 생성되는 물을 제거하기 위하여, 용제의 비점에서 반응시키는 것이 바람직하다.

<129> <합성법 3>

<130> 전하 수송성 폴리에테르의 또 다른 합성법으로서는, 예를 들면 이소시아나화 시클로헥실 등의 이소시아나화 알킬, 시안화 시클로헥실 등의 시안화 알킬, 시안산 p-톨릴이나 2,2-비스(4-시아네이트 페닐)프로판 등의 시안산 에스테르, 디클로로헥실카르보다이미드(DCC), 트리클로로아세트니트릴 등의 축합제를 사용하는 방법(합성법 3)도 들 수 있다. 이 경우, 축합제는 전하 수송성 모노머 1당량에 대하여, 바람직하게는 1/2당량 이상 10당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 3당량 이하의 범위로 사용된다.

<131> 용제로서는, 톨루엔, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 1-클로로나프탈렌 등이 유효하며, 전하 수송성 모노머 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 100당량 이하, 보다 바람직하게는 2당량 이상 50당량 이하의 범위로 사용된다.

<132> 반응 온도는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 실온(예를 들면, 25℃) 이상이며, 또한 용제의 비점 이하인 범위의 온도에서 반응시키는 것이 바람직하다.

<133> 상기 합성법 1, 합성법 2, 및 합성법 3 중, 이성화나 부반응이 일어나기 어려우므로, 합성법 1 또는 합성법 3이 바람직하다. 특히 합성법 3은 반응 조건이 온화하므로 보다 바람직하다.

<134> 반응 종료 후, 용제를 사용하지 않은 경우에는 용해 가능한 용제에 용해시킨 것을, 용제를 사용한 경우에는 그 대로의 용액을, 전하 수송성 폴리에테르가 용해되기 어려운 빈용제(예를 들면, 메탄올, 에탄올 등의 알코올류나, 아세톤 등) 중에 적하하여, 전하 수송성 폴리에테르를 석출시킨다. 그 후, 전하 수송성 폴리에테르를 분리하여, 물이나 유기 용제로 충분히 세정하고, 건조시킨다. 또한 필요하면, 재침전 처리(구체적으로는, 적당한 유기 용제에 용해시켜, 빈용제 중에 적하하여, 전하 수송성 폴리에테르를 석출시키는 처리)를 반복해도 된다.

<135> 재침전 처리 시에는, 메커니컬 스테러 등으로, 효율 좋게 교반하면서 행하는 것이 바람직하다.

<136> 재침전 처리 시에, 전하 수송성 폴리에테르를 용해시키는 용제는 전하 수송성 폴리에테르 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 100당량 이하, 보다 바람직하게는 2당량 이상 50당량 이하의 범위로 사용된다.

<137> 또한, 빈용제는 전하 수송성 폴리에테르 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 1,000당량 이하, 보다 바람직하게는 10당량 이상 500당량 이하의 범위로 사용된다.

<138> 또한, 상기 반응에서, 전하 수송성 모노머를 2종 이상, 바람직하게는 2종~5종, 더 바람직하게는 2종~3종 사용함으로써, 공중합 폴리머의 합성도 가능하다. 이종(異種)의 전하 수송성 모노머를 공중합함으로써, 전기 특성, 성막성, 용해성을 제어할 수 있다.

<139> 전하 수송성 폴리에테르의 말단기는 전하 수송성 모노머와 마찬가지로 히드록시기(즉, 상기 일반식 (I) 중의 R이 수소 원자)이어도 되지만, 용해성, 성막성, 모빌리티 등의 폴리머 물성에 영향을 미치게 하려는 경우에는, 말단기 R을 수식(修飾)하여 물성을 제어할 수 있다.

<140> 예를 들면, 전하 수송성 폴리에테르 말단의 히드록시기를 황산알킬, 요오드화알킬 등으로 알킬에테르화할 수 있다. 알킬에테르화하기 위한 구체적인 시약으로서, 예를 들면 황산디메틸, 황산디에틸, 요오드화메틸, 요오드

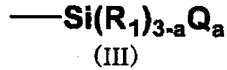
화에틸 등을 들 수 있다. 상기 시약은 말단의 히드록시기 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 3당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 2당량 이하의 범위로 사용한다. 알킬에테르화할 때, 염기 촉매를 사용할 수 있는데, 염기 촉매로서는, 예를 들면 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수소화나트륨, 나트륨 금속 등을 들 수 있다. 염기 촉매는 말단의 히드록시기 1당량에 대하여, 바람직하게는 0.9당량 이상 3당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 2당량 이하의 범위로 사용된다.

- <141> 알킬에테르화에 있어서의 반응 온도는, 예를 들면 0℃ 이상이며, 또한 사용하는 용제의 비점 이하인 범위의 온도에서 행할 수 있다. 또한, 알킬에테르화할 때에 사용하는 용제로서, 예를 들면 벤젠, 톨루엔, 염화메틸렌, 테트라히드로푸란, N,N-디메틸포름아미드, 디메틸술폰시드, N-메틸피롤리돈, 1,3-디메틸-2-이미다졸리디논 등의 불활성 용제에서 선택한 단독 용제, 또는 2종~3종의 혼합 용제를 사용할 수 있다.
- <142> 또한 필요에 따라, 상간 이동 촉매로서 테트라-n-부틸암모늄 아이오다이드 등의 제4급 암모늄염을 사용할 수도 있다.
- <143> 또한, 전하 수송성 폴리에테르 말단의 히드록시기를, 산할로젠화물을 사용하여 아실화(즉, 상기 일반식 (I) 중의 R을 아실기로 함)할 수도 있다.
- <144> 산할로젠화물은 특별히 한정하는 것은 아니지만, 예를 들면 아크릴로일 클로라이드, 크로토노일 클로라이드, 메타크릴로일 클로라이드, 2-푸로일 클로라이드, 벤조일 클로라이드, 시클로헥산 카르보닐 클로라이드, 에난틸 클로라이드, 페닐아세틸 클로라이드, o-톨루오일 클로라이드, m-톨루오일 클로라이드, p-톨루오일 클로라이드 등을 들 수 있다. 산할로젠화물은 말단의 히드록시기 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 3당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 2당량 이하의 범위로 사용한다.
- <145> 아실화할 때, 염기 촉매를 사용할 수 있다. 염기 촉매로서는, 예를 들면 피리딘, 디메틸아미노피리딘, 트리메틸아민, 트리에틸아민 등을 들 수 있다. 염기 촉매는 산할로젠화물 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 3당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 2당량 이하의 범위로 사용한다.
- <146> 아실화할 때 사용하는 용제로서, 예를 들면 벤젠, 톨루엔, 염화메틸렌, 테트라히드로푸란, 메틸에틸케톤 등을 들 수 있다.
- <147> 아실화에 있어서의 반응 온도는, 예를 들면 0℃ 이상이며, 또한 사용하는 용제의 비점 이하인 범위의 온도로 할 수 있다. 바람직하게는, 0℃ 이상 30℃ 이하의 범위에서 반응을 행한다.
- <148> 또한, 무수 아세트산 등의 산무수물을 사용함으로써 아실화할 수도 있다. 용제를 사용하는 경우에는, 용제로서 구체적으로는, 벤젠, 톨루엔, 클로로벤젠 등의 불활성 용제를 들 수 있다.
- <149> 산무수물을 사용하여 아실화할 때의 반응 온도로서는, 예를 들면 0℃ 이상이며, 또한 사용하는 용제의 비점 이하인 범위의 온도를 들 수 있다. 바람직하게는, 50℃ 이상이며, 또한 사용하는 용제의 비점 이하인 범위의 온도이다.
- <150> 상기한 바와 같이, 전하 수송성 폴리에테르 말단의 히드록시기를 알킬에테르화 또는 아실화하는 것 외에, 모노이소시아네이트를 사용하여 우레탄 잔기를 도입(즉, 상기 일반식 (I) 중의 R을 기 -CONH-R'로 함)할 수 있다.
- <151> 구체적인 모노이소시아네이트로서는, 예를 들면 이소시아산 벤질에스테르, 이소시아산 n-부틸에스테르, 이소시아산 t-부틸에스테르, 이소시아산 시클로헥실에스테르, 이소시아산 2,6-디메틸에스테르, 이소시아산 에틸에스테르, 이소시아산 이소프로필에스테르, 이소시아산 2-메톡시페닐에스테르, 이소시아산 4-메톡시페닐에스테르, 이소시아산 n-옥타데실에스테르, 이소시아산 페닐에스테르, 이소시아산 이소프로필에스테르, 이소시아산 m-톨릴에스테르, 이소시아산 p-톨릴에스테르, 이소시아산 1-나프틸에스테르 등을 들 수 있다. 모노이소시아네이트는 말단의 히드록시기 1당량에 대하여, 바람직하게는 1당량 이상 3당량 이하, 보다 바람직하게는 1당량 이상 2당량 이하의 범위로 사용한다.
- <152> 우레탄 잔기를 도입할 때 사용하는 용제로서는, 예를 들면 벤젠, 톨루엔, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 염화메틸렌, 테트라히드로푸란, N,N-디메틸포름아미드, 디메틸술폰시드, N-메틸피롤리돈, 1,3-디메틸-2-이미다졸리디논 등을 들 수 있다.
- <153> 우레탄 잔기를 도입할 때의 반응 온도로서는, 예를 들면 0℃ 이상이며, 또한 사용하는 용제의 비점 이하인 범위의 온도를 들 수 있다. 반응이 진행하기 어려운 경우에는, 예를 들어 디라우르산 디부틸주석(II), 옥틸주석(II), 나프텐산납 등의 금속 화합물, 또는 트리에틸아민, 트리메틸아민, 피리딘, 디메틸아미노피리딘 등의 3급

아민을 촉매로서 첨가할 수도 있다.

<154> 이하, 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료에 관하여 설명한다.

<155> 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료는, 예를 들면 치환 규소기가 가수분해성기를 포함하므로, 서로 가교 반응을 일으켜, 3차원 -Si-O-Si- 결합, 즉 무기 유리질 망상 구조(네트워크)를 형성하는 3차원 가교성 재료이다.



<156>

<157> 단, 일반식 (III) 중, R₁은 수소, 알킬기, 또는 치환 또는 미치환의 아릴기를 나타내고, Q는 가수분해성기를 나타내고, a는 1~3의 정수를 나타낸다.

<158>

일반식 (III) 중, R₁로 표시되는 알킬기로서는, 예를 들면 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기 등을 들 수 있다.

<159>

일반식 (III) 중, R₁로 표시되는 아릴기로서는, 탄소수 6~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 페닐기, 톨루일기 등을 들 수 있다. 아릴기의 치환기로서는, 알킬기, 알콕시기, 페녹시기, 아릴기, 아랄킬기, 치환 아미노기, 할로젠 원자 등을 들 수 있다.

<160>

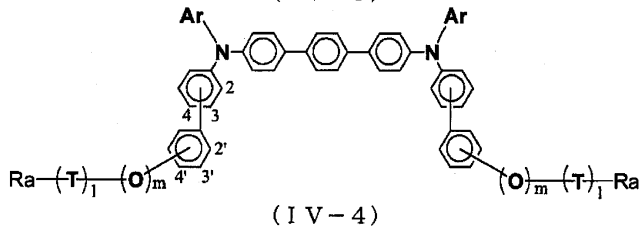
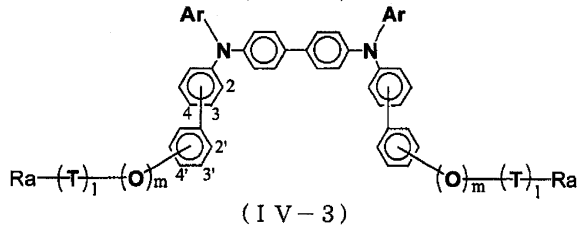
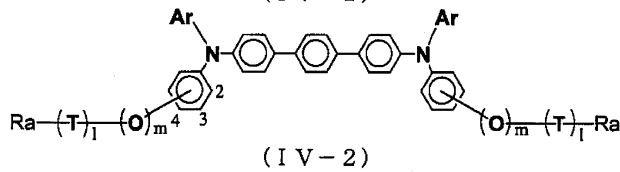
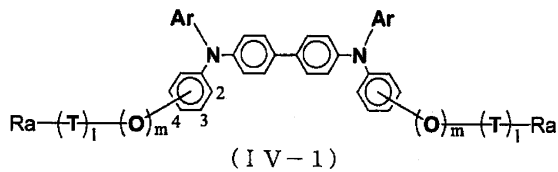
여기서, 아릴기의 치환기로서의 알킬기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기 등을 들 수 있다. 알콕시기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메톡시기, 에톡시기, 프로폭시기, 이소프로폭시기 등을 들 수 있다. 아릴기로서는, 탄소수 6~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 페닐기, 톨루일기 등을 들 수 있다. 아랄킬기로서는, 탄소수 7~20의 것이 바람직하고, 예를 들면 벤질기, 페네틸기 등을 들 수 있다. 치환 아미노기의 치환기로서는, 알킬기, 아릴기, 아랄킬기 등을 들 수 있고, 구체적인 예는 상술한 바와 같다(일반식 (I) 참조).

<161>

Q로 표시되는 가수분해성기로서는, 예를 들면 알콕시기, 메틸에틸케토옥심기, 디에틸아미노기, 아세톡시기, 프로페녹시기, 할로젠 등을 들 수 있다. 알콕시기로서는, 탄소수 1~10의 것이 바람직하고, 예를 들면 메톡시기, 에톡시기, 프로폭시기, 이소프로폭시기 등을 들 수 있다.

<162>

일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 구체적으로는, 테트라페닐렌디아민 유도체, 트리페닐아민 유도체, 카르바졸 유도체, 스틸벤 유도체, 아릴히드라존 유도체 등의 방향족 화합물을 들 수 있다. 이들 중에서도, 하기 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물이 적합하다.



<163>

<164>

단, 일반식 (IV-1)~(IV-4) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타내고, Ra는 상기 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기의 적어도 1종을 나타내고, m, l은 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소 또는 탄소수 2~10의 분지상 탄화수소를 나타낸다.

<165>

일반식 (IV-1)~(IV-4) 중, Ar은 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타낸다. 구체적으로는, Ar은 치환 또는 미치환의 페닐기, 치환 또는 미치환의 방향족수 2~10의 1가의 다핵 방향족 탄화수소, 치환 또는 미치환의 방향족수 2~10의 1가의 축합환 방향족 탄화수소, 치환 또는 미치환의 1가의 방향족 복소환, 또는, 적어도 1종의 방향족 복소환을 포함하는 치환 또는 미치환의 1가의 방향족기를 나타낸다.

<166>

여기서, 「다핵 방향족 탄화수소」, 「축합환 방향족 탄화수소」, 「방향족 복소환」, 「방향족 복소환을 포함하는 방향족기」에 관해서는 상술한 바와 같다.

<167>

일반식 (IV-1)~(IV-4) 중, l, m은 0 또는 1을 나타내고, T는 탄소수 1~6의 2가의 직쇄상 탄화수소, 또는 탄소수 2~10의 2가의 분지쇄상 탄화수소를 나타내고, 바람직하게는 탄소수가 2~6의 2가의 직쇄상 탄화수소, 및 탄소수 3~7의 2가의 분지쇄상 탄화수소에서 선택된다. T의 구체적인 구조로서는 상기와 동일하다.

<168>

이상 설명한 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물은, 공유결합을 거쳐 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소기를 말단에 갖게 되는 것이며, 방향족 아민 구조 단위를 갖는 3차원 가교물을 형성할 수 있는 3차원 가교성 전하 수송 재료이다.

<169>

또한, 일반식 (IV-1) 및 (IV-2)에서의 방향족 아민 구조는 일반식 (II-1)로 표시되는 구조의 X로 표시되는 부분을 비페닐 또는 터페닐로 한 것이며, 일반식 (IV-3) 및 (IV-4)에서의 방향족 아민 구조는 일반식 (II-2)로 표시되는 구조의 X로 표시되는 부분을 비페닐 또는 터페닐로 한 것이다.

<170>

여기서, 일반식 (IV-1)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물에서, Ar은 페닐, 비페닐, 나프탈렌, 9,9'-디메틸플루오렌을 나타내고(방향족의 치환기로서는, 메틸기, 에틸기, 이소프로필기, tert-부틸기, 메톡시기가 바람직함), m은 0을, l은 1을 나타내고, T는 메틸렌기, 디메틸렌기를 나타내고, Ra는 $-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$, $-\text{SiH}(\text{OCH}_3)_2$ 를 나타내는 것이 적합하다.

<171>

일반식 (IV-1)~(IV-2)로 표시되는 방향족 아민 화합물의 구체적인 예로서는, 이하의 것을 들 수 있다.

<172> <표 1>

No.	Ar	i	m	T	Ra	결합위치
1		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
2		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	3
3		1	1	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
4		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-SiH(OCH_3)_2$	4
5		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
6		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
7		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-SiH(OCH_3)_2$	4
8		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OC_2H_5)_3$	4
9		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
10		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
11		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-SiH(OCH_3)_2$	4
12		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4
13		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4

<173>

<174> 일반식 (IV-3)~(IV-4)로 표시되는 방향족 아민 화합물의 구체적인 예로서는, 이하의 것을 들 수 있다.

<175> <표 2>

No.	Ar	i	m	T	Ra	결합 위치
1		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'
2		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'
3		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'
4		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OC_2H_5)_3$	4,4'
5		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'
6		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'
7		1	0	$-(CH_2)_2-$	$-Si(OCH_3)_3$	4,4'

<176>

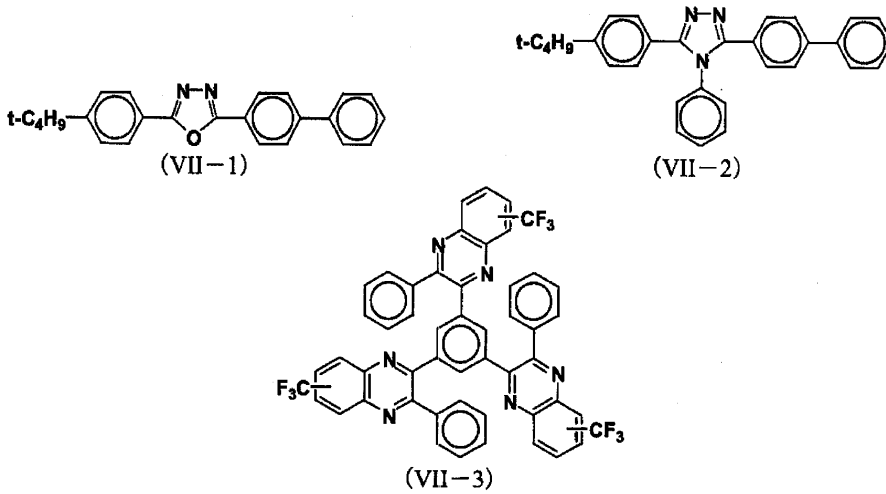
<177> 다음에, 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자의 층 구성에 대하여 상세히 기술한다.

<178> 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자는, 적어도 한쪽이 투명 또는 반투명한 한 쌍의 양극 및 음극으로 이루어지는 전극과, 이 한 쌍의 전극 사이에 끼워진, 발광층 및 버퍼층을 포함하는 2층 이상으로 이루어지는 유기 화합물층을 포함하는 층 구성을 갖는다. 그리고 버퍼층은 1층 이상의, 일반식 (III)으로 표시되는 치환 규소가

를 갖는 전하 주입 재료를 함유하고, 양극과 접하여 마련된다. 또한, 유기 화합물층의 적어도 한 층은, 적어도 1종의 상기 전하 수송성 폴리테르를 함유한다.

- <179> 더하여, 상기 전하 수송성 폴리테르를 함유하는 유기 화합물층 중에서 가장 양극에 가까운 층에 위치하는 유기 화합물층의 막두께를 20nm 이상 100nm 이하의 범위(보다 바람직하게는, 20nm 이상 80nm 이하, 보다 더 바람직하게는 20nm 이상 50nm 이하) 내로 하는 것이 바람직하다. 이 유기 화합물층은, 유기 화합물층이 단층형의 경우, 전하 수송능을 갖는 발광층이며, 기능 분리형(적층형)의 경우, 정공 수송층인 것이 좋다.
- <180> 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자에서는, 유기 화합물층이 버퍼층 및 발광층만으로 구성되는 경우에는, 이 발광층은 전하 수송능을 갖는 발광층을 의미하고, 이 전하 수송능을 갖는 발광층이 상기 전하 수송성 폴리테르를 함유하여 이루어진다.
- <181> 또한, 유기 화합물층이 버퍼층 및 발광층에 더하여, 1층 이상의 다른 층을 더 가질 경우(3층 이상의 기능 분리형의 경우)에는, 버퍼층 및 발광층을 제외한 그 밖의 층은 캐리어 수송층, 즉 정공 수송층, 전자 수송층, 또는 정공 수송층 및 전자 수송층으로 이루어지는 것을 의미하고, 이들의 적어도 한 층에 상기 전하 수송성 폴리테르가 함유된다.
- <182> 구체적으로는, 유기 화합물층은, 예를 들면 적어도 버퍼층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성, 또는 적어도 버퍼층, 정공 수송층 및 발광층을 포함하는 구성이어도 된다. 이 경우, 이들의 적어도 한 층(정공 수송층, 전자 수송층, 발광층)에 상기 전하 수송성 폴리테르가 함유되어 있는 것이 바람직하지만, 적합하게는 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테르가 함유되어 있는 것이 바람직하다. 그리고 특히, 적어도 버퍼층과 접하는 발광층, 정공 수송층에 상기 전하 수송성 폴리테르를 함유하는 것이 적합하다.
- <183> 또한, 버퍼층 및 발광층만으로 구성되는 경우, 버퍼층은 양극과 발광층의 사이에 마련된다. 또한, 적어도 버퍼층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성의 경우, 버퍼층은 양극과 발광층의 사이에 마련된다. 또한, 적어도 버퍼층, 정공 수송층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성의 경우, 버퍼층은 양극과 정공 수송층의 사이에 마련된다. 또한, 적어도 버퍼층, 정공 수송층 및 발광층을 포함하는 구성의 경우, 버퍼층은 양극과 정공 수송층의 사이에 마련된다.
- <184> 여기서, 버퍼층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성에서는, 다른 층 구성에 비하여, 제조 용이성과 발광 효율의 양립이 도모된다. 이것은, 모두 기능 분리한 층 구성에 비하여 층 수가 적은 한편, 일반적으로 정공에 비하여 이동도가 낮은 전자의 주입 효율을 보충하여, 발광층에서의 전하의 균형이 도모되기 때문이라고 생각된다.
- <185> 버퍼층, 정공 수송층, 발광층 및 전자 수송층을 포함하는 구성에서는, 다른 층 구성의 소자에 비하여, 발광 효율이 뛰어나, 저전압 구동이 가능해진다. 이것은, 모두 기능 분리함으로써 다른 층 구성에 비하여, 전하의 주입 효율이 가장 높아져, 발광층에서 전하가 재결합 가능하기 때문이라고 생각된다.
- <186> 버퍼층, 정공 수송층 및 발광층을 포함하는 구성에서는, 다른 구성에 비하여, 제조 용이성과 내구성의 양립이 도모된다. 이것은, 모두 기능 분리한 층 구성에 비하여 층 수가 적은 한편, 발광층으로의 정공의 주입 효율이 향상되어, 발광층으로 과잉의 전자 주입이 억제되기 때문이라고 생각된다.
- <187> 버퍼층 및 발광층만으로 구성되는 경우에는, 다른 층 구성에 비하여, 소자의 대면적화 및 제조가 용이하다. 이것은 층 수가 적고, 예를 들면 습식 도포 등에 의해 제작할 수 있기 때문이다.
- <188> 또한, 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자에서는, 발광층이 전하 수송성 재료(상기 전하 수송성 폴리테르 이외의 정공 수송성 재료, 전자 수송성 재료)를 함유해도 되고, 이와 같은 전하 수송성 재료의 상세한 것에 대해서는 후술한다.
- <189> 이하, 도면을 참조하면서, 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자에 대하여 보다 상세히 설명하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다.
- <190> 도 1~도 4는 본 실시 형태에 따른 유기 전계발광 소자의 층 구성을 설명하기 위한 모식 단면도이며, 도 1, 도 2, 도 3의 경우는, 유기 화합물층이 3층 또는 4층 구성인 경우의 일례이며, 도 4의 경우는, 유기 화합물층이 2층 구성인 경우의 예를 나타낸다. 또한, 도 1~도 4에서, 동일한 기능을 갖는 것은 동일한 부호를 붙여 설명한다.

- <191> 도 1에 나타난 유기 전계발광 소자(10)는, 투명 절연체 기관(1) 위에, 투명 전극(2), 버퍼층(3), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 배면 전극(8)을 순차적으로 적층하여 이루어진다.
- <192> 도 2에 나타난 유기 전계발광 소자(10)는, 투명 절연체 기관(1) 위에, 투명 전극(2), 버퍼층(3), 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 배면 전극(8)을 순차적으로 적층하여 이루어진다.
- <193> 도 3에 나타난 유기 전계발광 소자(10)는, 투명 절연체 기관(1) 위에, 투명 전극(2), 버퍼층(3), 정공 수송층(4), 발광층(5) 및 배면 전극(8)을 순차적으로 적층하여 이루어진다.
- <194> 도 4에 나타난 유기 전계발광 소자(10)는, 투명 절연체 기관(1) 위에, 투명 전극(2), 버퍼층(3), 전하 수송능을 갖는 발광층(7) 및 배면 전극(8)을 순차적으로 적층하여 이루어진다.
- <195> 또한, 도 1~4 중, 투명 전극(2)이 양극을 의미하고, 배면 전극(8)이 음극을 의미한다. 이하, 각각을 상세히 설명한다.
- <196> 또한, 상기 전하 수송성 폴리에테르가 함유되는 층은, 그 구조에 따라서는, 도 1에 나타난 유기 전계발광 소자(10)의 층 구성의 경우, 발광층(5), 전자 수송층(6)으로서 모두 작용할 수 있고, 도 2에 나타난 유기 전계발광 소자(10)의 층 구성의 경우, 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송층(6)으로서 모두 작용할 수 있고, 도 3에 나타난 유기 전계발광 소자(10)의 층 구성의 경우, 정공 수송층(4), 발광층(5)으로서 모두 작용할 수 있고, 도 4에 나타난 유기 전계발광 소자(10)의 층 구성의 경우, 전하 수송능을 갖는 발광층(7)으로서 작용할 수 있다. 특히, 적합하게는 정공 수송 재료로서 작용할 수 있다.
- <197> 투명 절연체 기관(1)은 발광을 취출하기 위하여 투명한 것이 바람직하여, 유리, 플라스틱 필름 등이 사용되지만 이것에 한정되는 것은 아니다. 또한, 투명 전극(2)은 투명 절연체 기관과 마찬가지로, 발광을 취출하기 위하여 투명하며, 또한 정공의 주입을 행하기 위하여 일함수(이온화 퍼텐셜)가 큰 것이 바람직하여, 산화주석인듐(ITO), 산화주석(NESA), 산화인듐, 산화아연 등의 산화막, 및 증착 또는 스퍼터링된 금, 백금, 팔라듐 등이 사용되지만 이것에 한정되는 것은 아니다.
- <198> 또한, 버퍼층(3)은 양극(투명 전극(2))과 접하여 형성되고, 1층 이상의 전하 주입 재료를 함유한다. 그리고, 전하 주입 재료로서, 상기 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료를 사용하여 형성된다. 구체적으로는, 예를 들면 버퍼층(3)은 상기 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료에 의해 형성되는 3차원 가교물을 함유하여 구성되어 있다.
- <199> 또한, 전하 주입 재료는 버퍼층(3)의 양극이 마련된 측과 반대측의 면에 접하여 마련되는 층(즉, 도 1에서는 발광층(5), 도 2 및 3에서는 정공 수송층(4), 도4에서는 전하 수송능을 갖는 발광층(7))으로의 전하의 주입성을 향상시키기 위하여, 그 이온화 퍼텐셜은 5.4eV 이하인 것이 바람직하고, 5.1eV 이하인 것이 보다 바람직하다. 또한, 버퍼층(3)의 층 수에 관해서도 특별히 제한은 없지만, 1층 또는 2층인 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 1층이다.
- <200> 또한, 버퍼층(3)을 구성하는 재료는, 상기 재료 외에, 바인더 수지 등 다른 전하 주입성을 갖지 않는 재료도 필요에 따라 더 사용할 수 있다.
- <201> 전자 수송층(6)은, 목적에 따라 기능(전자 수송능)이 부여된 상기 전하 수송성 폴리에테르 단독으로 형성되어 있어도 되지만, 전기적 특성을 더욱 개선하려는 등의 목적에서, 전자 이동도를 조절하기 위하여, 전하 수송성 폴리에테르 이외의 전자 수송 재료를 1중량%~50중량%의 범위로 혼합 분산하여 형성되어 있어도 된다.
- <202> 이와 같은 전자 수송 재료로서는, 적합하게는 예를 들면 옥사디아졸 유도체, 트리아졸 유도체, 페닐퀴놀살린 유도체, 니트로 치환 플루오레논 유도체, 디페노퀴논 유도체, 티오피란 디옥시드 유도체, 플루오레닐리덴 메탄 유도체 등을 들 수 있다. 적합한 구체적인 예로서, 하기 화합물(VII-1)~(VII-3)을 들 수 있지만, 이들에 한정되는 것은 아니다. 또한, 상기 전하 수송성 폴리에테르를 사용하지 않고 전자 수송층(6)을 형성하는 경우, 전자 수송층(6)은 이들 전자 수송성 재료를 사용하여 형성된다.



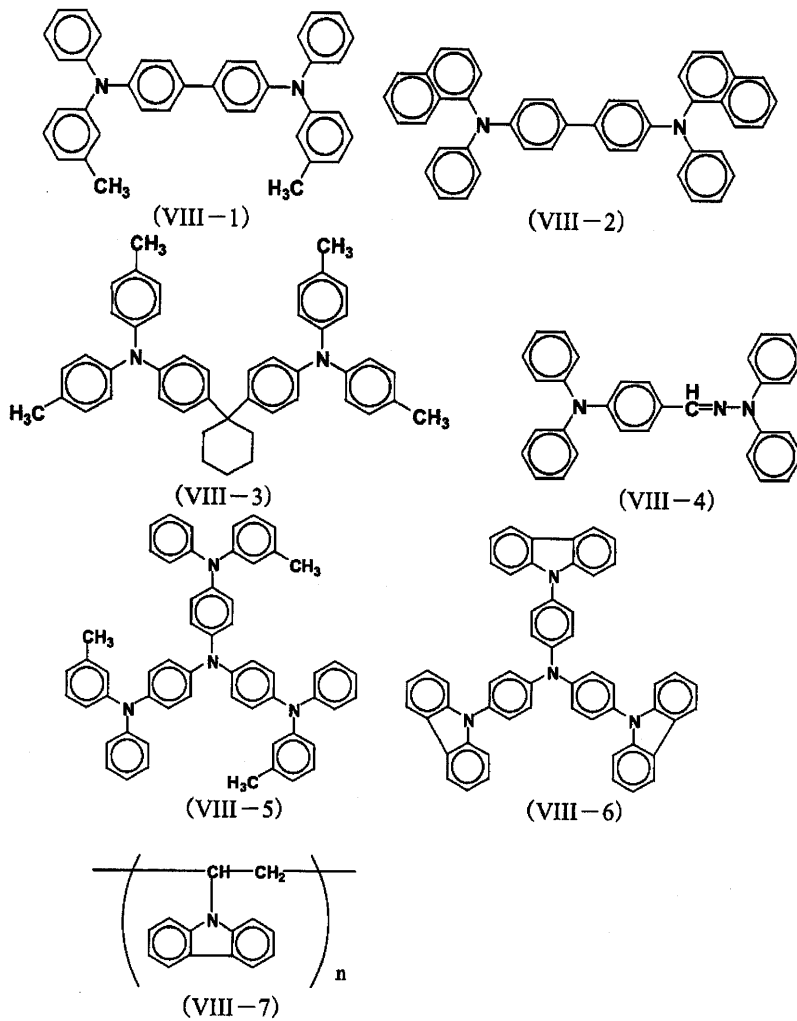
<203>

<204>

정공 수송층(4)은, 목적에 따라 기능(정공 수송능)이 부여된 전하 수송성 폴리에테르 단독으로 형성되어 있어도 되지만, 정공 이동도를 조절하기 위하여 전하 수송성 폴리에테르 이외의 정공 수송 재료를 1중량%~50중량%의 범위로 혼합 분산하여 형성되어 있어도 된다.

<205>

이 정공 수송 재료로서는, 테트라페닐렌디아민 유도체, 트리페닐아민 유도체, 카르바졸 유도체, 스티벤 유도체, 아릴히드라존 유도체, 포르피린계 화합물 등, 특히 적합한 구체적 예로서 하기 화합물(VIII-1)~(VIII-7)을 들 수 있지만, 전하 수송성 폴리에테르와의 상용성이 좋으므로, 테트라페닐렌디아민 유도체가 바람직하다. 또한, 다른 범용 수지 등과 혼합하여 사용해도 된다. 또한, 상기 전하 수송성 폴리에테르를 사용하지 않고 정공 수송층(4)을 형성하는 경우에는, 정공 수송층(4)은 이들 정공 수송성 재료를 사용하여 형성되지만, 정공 수송층(4)은 버퍼층(3)과 접하므로, 적어도 1종의 전하 수송성 폴리에테르를 사용하여 형성되는 것이 바람직하다. 또한, 화합물(VIII-7)에서, n(정수값)은 10~100000의 범위 내인 것이 바람직하고, 1000~50000의 범위 내인 것이 보다 바람직하다.



<206>

<207>

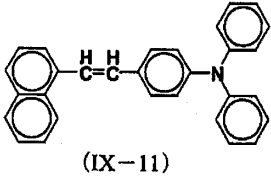
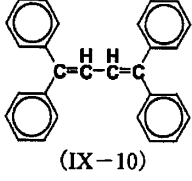
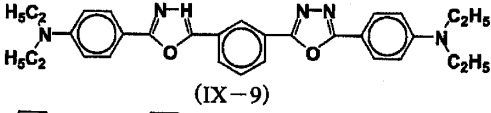
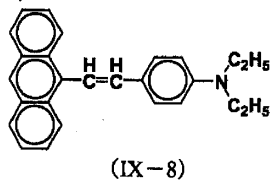
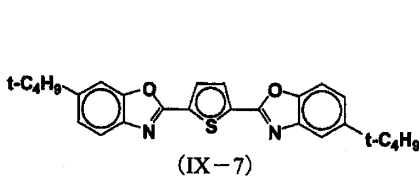
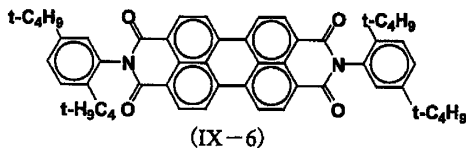
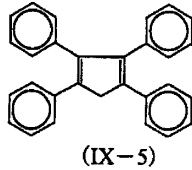
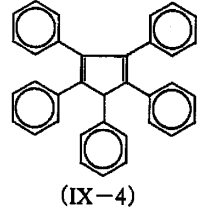
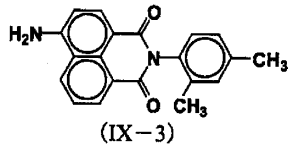
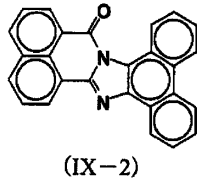
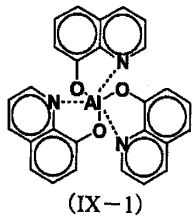
발광층(5)은 타종에 비하여, 고체 상태에서 높은 형광 양자 수율을 나타내는 화합물이 발광 재료로서 사용된다. 발광 재료가 유기 저분자의 경우, 진공 증착법 또는 저분자와 결합 수지를 함유하는 용액 또는 분산액을 도포·건조함으로써 양호한 박막 형성이 가능하다는 것이 조건이다. 또한 고분자의 경우, 그 자신을 함유하는 용액 또는 분산액을 도포·건조함으로써 양호한 박막 형성이 가능하다는 것이 조건이다.

<208>

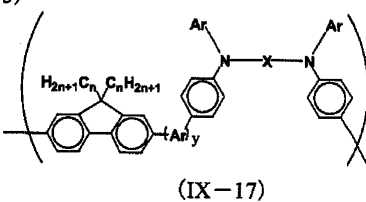
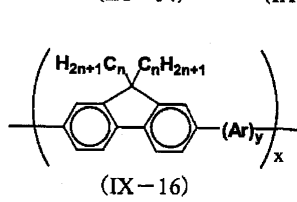
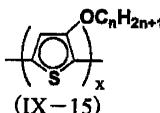
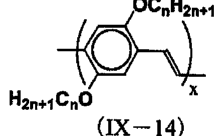
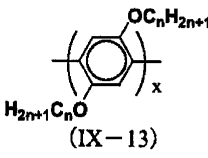
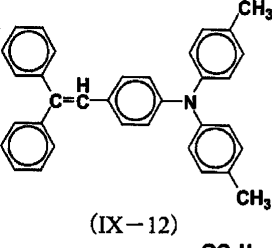
적합하게는, 유기 저분자의 경우, 킬레이트형 유기 금속 착체, 다핵 또는 축합 방향환 화합물, 페릴렌 유도체, 쿠마린 유도체, 스티릴아릴렌 유도체, 실롤 유도체, 옥사졸 유도체, 옥사티아졸 유도체, 옥사디아졸 유도체 등이, 고분자의 경우, 폴리파라페닐렌 유도체, 폴리파라페닐렌비닐렌 유도체, 폴리티오펜 유도체, 폴리아세틸렌 유도체, 폴리플루오렌 유도체 등을 들 수 있다. 적합한 구체적인 예로서, 하기 화합물(IX-1)~(IX-17)이 사용되지만, 이들에 한정되는 것은 아니다.

<209>

또한, 하기 구조식 (IX-13)~(IX-17) 중, Ar, X는 일반식 (II-1) 및 (II-2) 중에 나타낸 Ar, X와 동일한 구조를 갖는 1개의 기 또는 2개의 기를 의미하고, n 및 x는 1 이상의 정수를, y는 0 또는 1을 나타낸다.



<210>



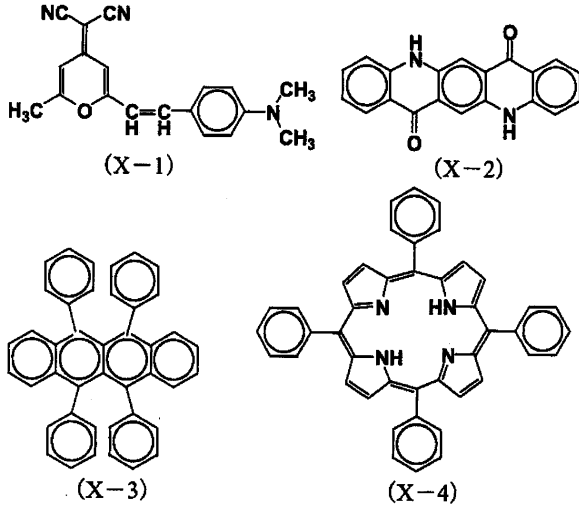
<211>

<212>

또한, 유기 전계발광 소자(10)의 내구성 향상 또는 발광 효율의 향상을 목적으로, 상기 발광 재료 중에 게스트 재료로서 발광 재료와 다른 색소 화합물을 도핑 해도 된다. 진공 증착에 의해 발광층을 형성하는 경우, 공(共)증착에 의해 도핑을 행하고, 용액 또는 분산액을 도포·건조함으로써 발광층을 형성하는 경우, 용액 또는 분산액 중에 혼합함으로써 도핑을 행한다. 발광층 중에 있어서의 색소 화합물의 도핑 비율로서는, 바람직하게

는 0.001중량% 이상 40중량% 이하, 보다 바람직하게는 0.01중량% 이상 10중량% 이하이다.

<213> 이 도핑에 사용되는 색소 화합물로서는, 발광 재료와의 상용성이 좋고, 또한 발광층의 양호한 박막 형성을 방해하지 않는 유기 화합물이 사용되며, 적합하게는DCM 유도체, 퀴나크리돈 유도체, 루브렌 유도체, 포르피린계 화합물 등을 들 수 있다. 적합한 구체적인 예로서, 하기 화합물(X-1)~(X-4)가 사용되지만, 이들에 한정되는 것은 아니다.

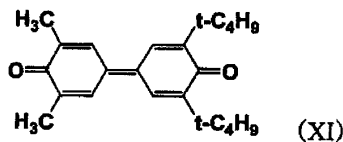


<214> 또한, 발광층(5)은 상기 발광성 재료 단독으로 형성되어 있어도 되지만, 전기 특성 및 발광 특성을 더욱 개선하려는 등의 목적에서, 상기 발광 재료에 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌 1중량%~50중량%의 범위로 혼합 분산하여 형성, 또는 상기 발광성 고분자 중에 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌 이외의 전하 수송 재료를 1중량%~50중량%의 범위로 혼합 분산하여 형성시켜도 된다.

<216> 또한, 상기 전하 수송성 고분자가 발광 특성도 겸비한 것일 경우, 발광 재료로서 사용해도 되고, 그 경우, 전기 특성 및 발광 특성을 더욱 개선하려는 등의 목적에서, 상기 발광 재료에 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌 이외의 전하 수송 재료를 1중량%~50중량%의 범위로 혼합 분산하여 형성시켜도 된다.

<217> 전하 수송능을 갖는 발광층(7)은, 예를 들면 목적에 따라 기능(정공 수송능, 또는 전자 수송능)이 부여된 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌 중에, 발광 재료로서 상기 발광 재료(IX-1)~(IX-17)를 발광층(7)의 전량에 대하여 50중량% 이하로 분산시킨 재료를 함유하는 것이 바람직하다. 이 경우, 유기 전계발광 소자(10)에 주입되는 정공과 전자의 밸런스를 조절하기 위하여 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌 이외의 전하 수송 재료를 발광층(7)의 전량에 대하여 10중량%~50중량% 분산시켜도 된다.

<218> 이 전하 수송 재료로서는, 전자 이동도를 조절할 경우, 전자 수송 재료로서 적합하게는 옥사디아졸 유도체, 니트로 치환 플루오레논 유도체, 디페노퀴논 유도체, 티오피란 디옥시드 유도체, 플루오레닐리덴 메탄 유도체 등을 들 수 있다. 적합한 구체적인 예로서, 상기 화합물(VII-1)~(VII-3)을 들 수 있다. 또한, 상기 전하 수송성 폴리테트라에틸렌과 강한 전자 상호작용을 나타내지 않는 유기 화합물이 사용되는 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 하기 화합물(XI)이 사용되지만, 이것에 한정되는 것은 아니다.



<219> 마찬가지로 정공 이동도를 조절할 경우, 정공 수송 재료로서 적합하게는 테트라페닐렌디아민 유도체, 트리페닐아민 유도체, 카르바졸 유도체, 스틸벤 유도체, 아릴히드라존 유도체, 포르피린계 화합물 등, 특히 적합한 구체적인 예로서 상기 화합물(VIII-1)~(VIII-7)을 들 수 있지만, 전하 수송성 폴리테트라에틸렌과의 상용성이 좋으므로, 테트라페닐렌디아민 유도체가 바람직하다.

<221> 배면 전극(8)에는, 진공 증착 가능하며, 전자 주입을 행하기 위하여 일함수가 작은 금속 원소가 사용되는데, 특히 바람직하게는 마그네슘, 알루미늄, 은, 인듐 및 이들의 합금, 또는 불화리튬이나 산화리튬 등의 금속 할로겐

화합물이나 금속 산화물을 들 수 있다.

- <222> 또한, 배면 전극(8) 위에는, 소자의 수분이나 산소에 의한 열화를 방지하기 위하여 보호층을 더 마련해도 된다. 구체적인 보호층 재료로서는, In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al 등의 금속, MgO, SiO₂, TiO₂ 등의 금속 산화물, 폴리 에틸렌 수지, 폴리우레아 수지, 폴리이미드 수지 등의 수지를 들 수 있다. 보호층의 형성에는, 진공 증착법, 스퍼터링법, 플라즈마 중합법, CVD법, 코팅법 등을 적용할 수 있다.
- <223> 이들 도 1~도 4에 나타낸 유기 전계발광 소자(10)의 제작은 이하의 순서로 행해진다. 우선, 투명 절연체 기판 (1) 위에 미리 형성된 투명 전극(2) 위에 버퍼층(3)을 형성한다. 구체적으로는 예를 들면, 버퍼층(3)을 구성하 는 재료를 용매 중에 용해 또는 분산시켜 소정의 농도로 하고, 얻어진 도포액을 사용하여 투명 전극(2) 위에 스 핀 코팅법, 디핑법 등을 이용하여 성막한다. 그리고 필요에 따라, 가열 등에 의해 경화시켜 버퍼층(3)을 형성 한다.
- <224> 버퍼층(3)을 구성하는 재료로서는, 예를 들면 상기 전하 주입 재료에 더하여, 상기한 바와 같이, 필요에 따라 정공의 트랩으로 되지 않을 정도의 바인더 수지나 도포성 개량제를 병용할 수 있다. 또한, 각종 목적에서, 다 른 실란 커플링제, 알루미늄 커플링제, 티타네이트 커플링제 등을 첨가할 수도 있다.
- <225> 다음에, 각 유기 전계발광 소자(10)의 층 구성에 따라, 버퍼층(3) 위에, 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송 층(6), 및 전하 수송능을 갖는 발광층(7)을 순차적으로 형성한다.
- <226> 또한, 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 전하 수송능을 갖는 발광층(7)은, 상기한 바와 같이 이들 각 층을 구성하는 재료를 사용하여 진공 증착법에 의해 형성한다. 또는, 이 재료를 유기 용매 중에 용해 또는 분산시켜 얻어진 도포액을 사용하여 스핀 코팅법, 디핑법 등을 이용하여 성막함으로써 형성된다.
- <227> 또한, 전하 수송 재료, 발광 재료로서 고분자를 사용하는 경우, 각 층의 형성은 도포액을 사용한 제막법에 의해 행하는 것이 바람직하지만, 잉크젯법을 이용하여 제막에 의해 행해도 된다.
- <228> 또한, 형성되는 버퍼층(3)의 막두께는, 바람직하게는 1nm 이상 100nm 이하이며, 1nm 이상 15nm 이하의 범위인 것이 보다 바람직하다.
- <229> 또한, 정공 수송층(4), 발광층(5) 및 전자 수송층(6)의 막두께는, 각각 바람직하게는 20nm 이상 100nm 이하이며, 특히 30~80nm의 범위인 것이 보다 바람직하다. 또한, 전하 수송능을 갖는 발광층(7)의 막두께는, 바람직하게는 20nm 이상 200nm 이하이며, 30nm 이상 200nm 이하가 보다 바람직하다.
- <230> 단, 버퍼층(3)과 접하는 유기 화합물층(정공 수송층(4), 발광층(5), 또는 전하 수송능을 갖는 발광층(7))이 전 하 수송성 폴리 에테르를 함유하는 경우에는, 버퍼층(3)과 접하는 유기 화합물층의 막두께는 20nm 이상 100nm 이 하인 것이 바람직하고, 30nm 이상 60nm 이하인 것이 보다 바람직하다.
- <231> 상기 각 재료(상기 전하 수송성 폴리 에테르, 발광 재료 등)를 유기 용매 중에 분산시켜 도포액을 제작하는 경우, 도포액 중에서의 상기 각 재료의 분산 상태는, 분자 분산 상태이어도 입자 분산 상태이어도 상관없다.
- <232> 도포액을 사용한 성막법의 경우, 분자 분산 상태로 하기 위해서는, 분산 용매는 상기 각 재료의 공통 용매를 사 용할 필요가 있으며, 입자 분산 상태로 하기 위하여 분산 용매는 상기 각 재료의 분산성 및 용해성을 고려하여 선택할 필요가 있다. 입자상으로 분산하기 위해서는, 볼밀, 샌드밀, 페인트 셰이커, 에트라이터, 호모지나이저, 초음파법 등을 이용할 수 있다.
- <233> 그리고, 마지막으로, 발광층(5), 전자 수송층(6) 또는 전하 수송능을 갖는 발광층(7) 위에 배면 전극(8)을 진공 증착법에 의해 형성함으로써 도 1~4에 나타낸 유기 전계발광 소자(10)를 얻을 수 있다.
- <234> (표시 장치)
- <235> 본 실시 형태의 표시 장치는 상기 본 실시 형태의 유기 전계발광 소자와, 유기 전계발광 소자를 구동하기 위한 구동 수단을 갖는다.
- <236> 표시 장치로서 구체적으로는, 예를 들면 도 1~4에 나타낸 바와 같이, 유기 전계발광 소자(10)의 한 쌍의 전극 (투명 전극(2), 배면 전극(8))에 연결되어, 그 한 쌍의 전극 사이에 직류 전압을 인가하기 위한 전압 인가 장치 (9)를 구동 수단으로서 구비한 것을 들 수 있다.
- <237> 전압 인가 장치(9)를 사용한 유기 전계발광 소자(10)의 구동 방법으로서, 예를 들면 한 쌍의 전극 사이에, 4V

이상 20V 이하이고, 전류 밀도 $1\text{mA}/\text{cm}^2$ 이상 $200\text{mA}/\text{cm}^2$ 이하의 직류 전압을 인가함으로써 유기 전계발광 소자 (10)를 발광시킬 수 있다.

<238> 또한, 본 실시 형태의 유기 전계발광 소자(10)는 최소단위(1화소단위)의 구성에 대하여 설명했지만, 예를 들면 그 1화소단위(유기 전계발광 소자)를 매트릭스 형상으로 배치한 표시 장치에 적용된다. 물론, 전극쌍을 매트릭스 형상으로 배치해도 된다.

<239> 또한, 표시 장치의 구동 방식으로서, 종래 공지의 기술, 예를 들면 복수의 행전극 및 열전극을 배치하고, 행 전극을 주사 구동하면서 각 행전극에 대응하는 화상 정보에 따라 열전극을 일괄하여 구동시키는 단순 매트릭스 구동이나, 각 화소마다 배치된 화소 전극에 의한 액티브 매트릭스 구동 등을 이용할 수 있다.

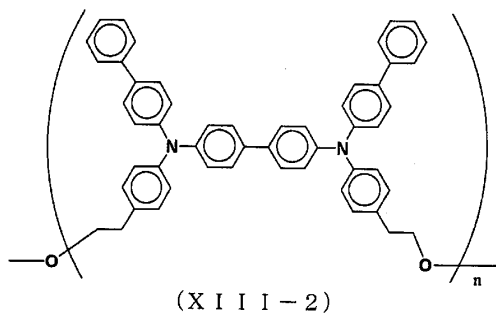
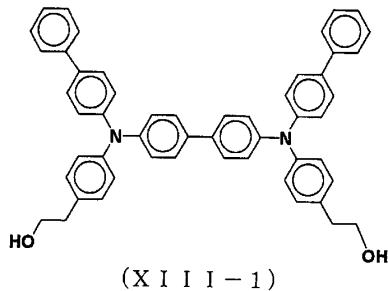
<240> [실시예]

<241> 이하, 본 발명을 실시예를 들어 더욱 구체적으로 설명한다. 단, 이들 각 실시예는 본 발명을 제한하는 것은 아니다.

<242> (전하 수송성 폴리에테르의 합성)

<243> <합성예 1>

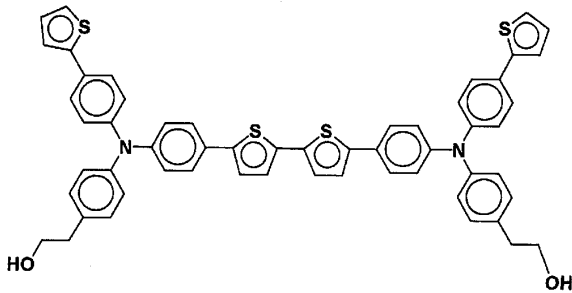
<244> 하기 화합물(XIII-1) 2.0g을 50ml의 3구 가지 형상 플라스크에 넣고, 4.8Pa의 감압하, 210°C에서 8시간 가열 반응을 계속했다. 그 후, 실온까지 냉각하고, 모노클로로벤젠 50ml에 가열 용해하여, 불용물을 0.5 μm 의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하고, 여과액을 교반하고 있는 메탄올 500ml 중에 적하하여, 폴리머를 석출시켰다. 얻어진 폴리머를 여과하고, 충분히 메탄올로 세정한 후, 건조시켜, 1.8g의 전하 수송성 폴리에테르(XIII-2)를 얻었다. 분자량 분포는 GPC(겔투과 크로마토그래피)로 측정하여, $M_w = 7.85 \times 10^4$ (스티렌 환산)이며, $M_w/M_n = 1.82$ 이었다.



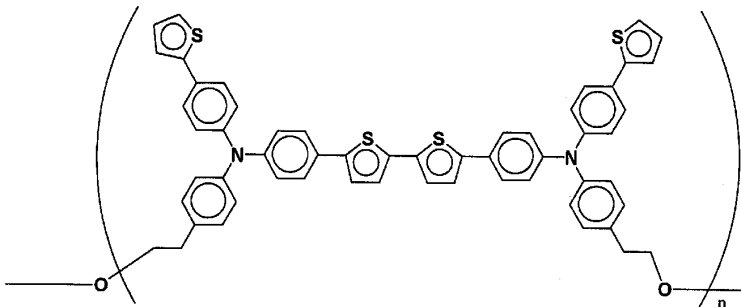
<245>

<246> <합성예 2>

<247> 하기 화합물(XIV-1) 2.0g을 50ml의 3구 가지 형상 플라스크에 넣고, 4.8Pa의 감압하, 210°C에서 8시간 가열 반응을 계속했다. 그 후, 실온까지 냉각하고, 모노클로로벤젠 50ml에 가열 용해하여, 불용물을 0.5 μm 의 PTFE 필터로 여과하고, 여과액을 교반하고 있는 메탄올 500ml 중에 적하하여, 폴리머를 석출시켰다. 얻어진 폴리머를 여과하고, 충분히 메탄올로 세정한 후, 건조시켜, 1.8g의 전하 수송성 폴리에테르(XIV-2)를 얻었다. 분자량 분포는 GPC(겔투과 크로마토그래피)로 측정하여, $M_w = 9.24 \times 10^4$ (스티렌 환산)이며, $M_w/M_n = 1.90$ 이었다.



(XIV-1)



(XIV-2)

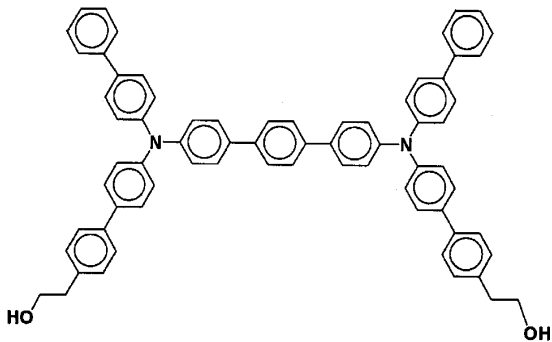
<248>

<249>

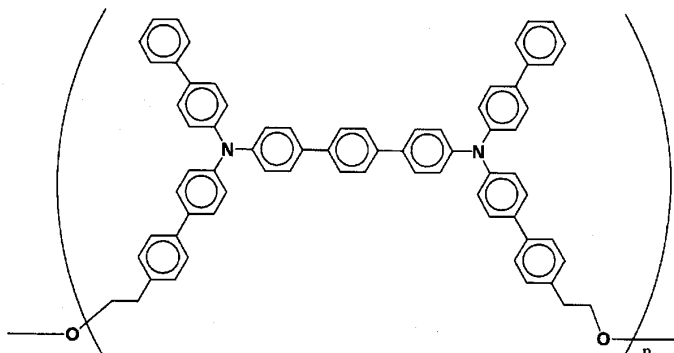
<합성예 3>

<250>

하기 화합물(XVII-1) 2.0g을 50ml의 3구 가지 형상 플라스크에 넣고, 4.8Pa의 감압하, 210℃에서 8시간 가열 반응을 계속했다. 그 후, 실온까지 냉각하고, 모노클로로벤젠 50ml에 가열 용해하여, 불용물을 0.5μm의 PTFE 필터로 여과하고, 여과액을 교반하고 있는 메탄올 500ml 중에 적하하여, 폴리머를 석출시켰다. 얻어진 폴리머를 여과하고, 충분히 메탄올로 세정한 후, 건조시켜, 1.8g의 전하 수송성 폴리에테르(XVII-2)를 얻었다. 분자량 분포는 GPC(겔투과 크로마토그래피)로 측정하여, $M_w = 1.04 \times 10^5$ (스티렌 환산)이며, $M_w/M_n = 2.04$ 이었다.



(XVII-1)



(XVII-2)

<251>

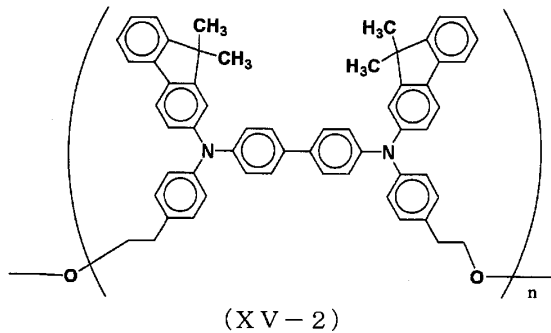
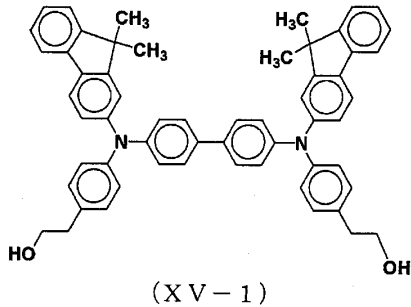
<252>

<합성예 4>

<253>

하기 화합물(XV-1) 2.0g을 50ml의 3구 가지 형상 플라스크에 넣고, 4.8Pa의 감압하, 210℃에서 8시간 가열 반응

을 계속했다. 그 후, 실온까지 냉각하고, 모노클로로벤젠 50ml에 가열 용해하여, 불용물을 0.5 μ m의 PTFE 필터로 여과하고, 여과액을 교반하고 있는 메탄올 500ml 중에 적하하여, 폴리머를 석출시켰다. 얻어진 폴리머를 여과하고, 충분히 메탄올로 세정한 후, 건조시켜, 1.9g의 전하 수송성 폴리에테르(XV-2)를 얻었다. 분자량 분포는 GPC(겔투과 크로마토그래피)로 측정하여, $M_w = 8.65 \times 10^4$ (스티렌 환산)이며, $M_w/M_n = 1.88$ 이었다.



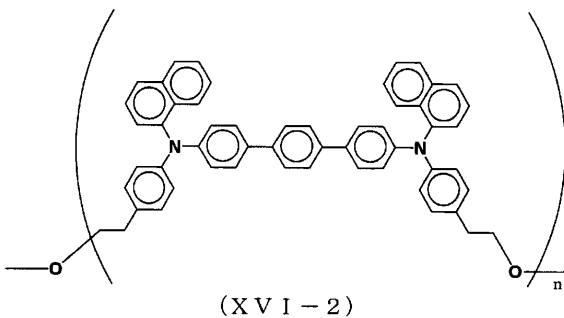
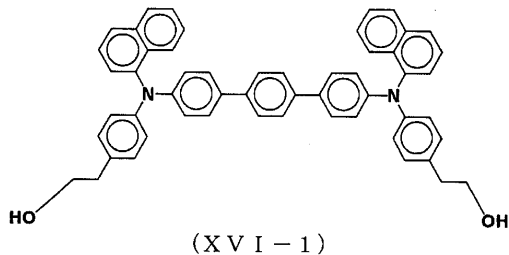
<254>

<255>

<합성예 5>

<256>

하기 화합물(XVI-1) 2.0g을 50ml의 3구 가지 형상 플라스크에 넣고, 4.8Pa의 감압하, 210 $^{\circ}$ C에서 8시간 가열 반응을 계속했다. 그 후, 실온까지 냉각하고, 모노클로로벤젠 50ml에 가열 용해하여, 불용물을 0.5 μ m의 PTFE 필터로 여과하고, 여과액을 교반하고 있는 메탄올 500ml 중에 적하하여, 폴리머를 석출시켰다. 얻어진 폴리머를 여과하고, 충분히 메탄올로 세정한 후, 건조시켜, 1.9g의 전하 수송성 폴리에테르(XVI-2)를 얻었다. 분자량 분포는 GPC(겔투과 크로마토그래피)로 측정하여, $M_w = 8.15 \times 10^4$ (스티렌 환산)이며, $M_w/M_n = 1.78$ 이었다.



<257>

<258>

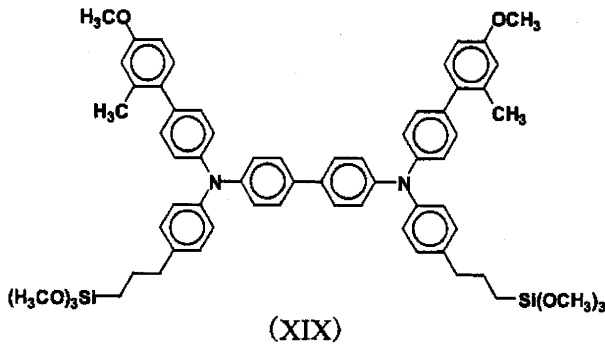
(유기 전계발광 소자의 제작)

<259>

다음에, 상기와 같이 합성한 전하 수송성 폴리에테르를 사용하여, 이하와 같이 유기 전계발광 소자를 제작했다.

<260> <실시예 1>

<261> 버퍼층 형성용 용액으로서 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료[하기 구조식 (XIX), 이온화 퍼텐셜 = 5.0eV] 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 용액을 제조했다.

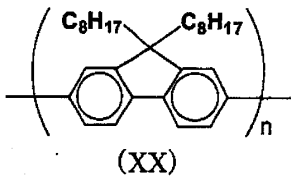


<262>

<263> 또한, 투명 전극 부착 기판으로서, 2mm 폭의 단책형(短冊型) ITO 전극을 에칭에 의해 형성한 기판(이하, 「ITO 전극 부착 유리 기판」이라 약기)을 준비하였다.

<264> 다음에, 상기 용액을 사용하여, 세정 건조시킨 ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 측의 면 위에, 스펀 코팅법에 의해 도포하여, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성했다.

<265> 다음에, 발광 재료로서 발광성 고분자[하기 화합물(XX), 폴리플루오렌계, $M_w \approx 10^5$]를 5중량%, 및 전기 특성 및 발광 특성을 더욱 개선하려는 등의 목적에서 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스펀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 발광층을 형성했다.



<266>

<267> 형성된 발광층을 충분히 건조시킨 후, 전자 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌[화합물(XIV-2)($M_w = 9.45 \times 10^4$)]를 5중량% 용해시킨 디클로로에탄 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 PTFE 필터로 여과한 후에, 이 용액을 발광층 위에 스펀 코팅법에 의해 도포하여, 막두께 30nm의 전자 수송층을 형성했다.

<268> 마지막으로, Mg-Ag 합금을 공증착에 의해 증착하여, 2mm 폭, 150nm 두께의 배면 전극을 ITO 전극과 교차하도록 형성했다. 형성된 유기 EL 소자의 유효 면적은 0.04cm²이었다.

<269> <실시예 2>

<270> 실시예 1과 마찬가지로, 세정한 ITO 전극 부착 유리 기판 위에, 상기 구조식 (XIX)[이온화 퍼텐셜 = 5.0eV]로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료에 의해 버퍼층을 형성한 후, 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스펀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성했다.

<271> 충분히 건조시킨 후, 발광 재료로서 발광성 고분자[상기 화합물(XX), 폴리플루오렌계, $M_w \approx 10^5$]를 5중량% 용해시킨 디클로로에탄 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 PTFE 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 정공 수송층 위에 스펀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 50nm의 발광층을 형성했다.

<272> 또한, 전자 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌[화합물(XIV-2)($M_w = 9.45 \times 10^4$)]를 5중량% 용해시킨 디클

로로에탄 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 PTFE 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 발광층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여, 막두께 30nm의 전자 수송층을 형성했다.

<273> 마지막으로, Mg-Ag 합금을 공증착에 의해 증착하여, 2mm 폭, 150nm 두께의 배면 전극을 ITO 전극과 교차하도록 형성했다. 형성된 유기 EL 소자의 유효 면적은 0.04cm²이었다.

<274> <실시예 3>

<275> 실시예 1과 마찬가지로, 세정한 ITO 전극 부착 유리 기판 위에, 상기 구조식 (XIX)[이온화 퍼텐셜 = 5.0eV]로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료에 의해 버퍼층을 형성한 후, 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)(Mw = 6.98 \times 10⁴)]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성했다.

<276> 충분히 건조시킨 후, 발광 재료로서 발광성 고분자[상기 화합물(XX), 폴리플루오렌계, Mw=10⁵]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 PTFE 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 정공 수송층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 50nm의 발광층을 형성했다.

<277> 마지막으로, Mg-Ag 합금을 공증착에 의해 증착하여, 2mm 폭, 150nm 두께의 배면 전극을 ITO 전극과 교차하도록 형성했다. 형성된 유기 EL 소자의 유효 면적은 0.04cm²이었다.

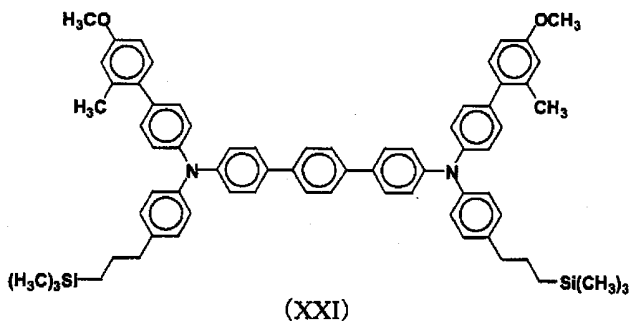
<278> <실시예 4>

<279> 실시예 1과 마찬가지로, 세정한 ITO 전극 부착 유리 기판 위에, 상기 구조식 (XIX)[이온화 퍼텐셜 = 5.0eV]로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료에 의해 버퍼층을 형성한 후, 정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)(Mw = 6.98 \times 10⁴)] 0.5중량부와, 발광 재료로서 발광성 고분자[화합물(XX), 폴리플루오렌계, Mw=10⁵] 0.1중량부를 혼합하고, 이들의 혼합물을 10중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과함으로써 발광층 형성용 용액을 준비했다.

<280> 이 용액을 사용하여, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 50nm의 전하 수송층을 갖는 발광층을 형성하고, 마지막으로 Mg-Ag 합금을 공증착에 의해 증착하여, 2mm 폭, 150nm 두께의 배면 전극을 ITO 전극과 교차하도록 형성했다. 형성된 유기 EL 소자의 유효 면적은 0.04cm²이었다.

<281> <실시예 5>

<282> 버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 하기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120 $^{\circ}$ C에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 1과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.



<283>

<284> <실시예 6>

<285> 버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 상기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120 $^{\circ}$ C에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한

이외는, 실시예 2와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 7>

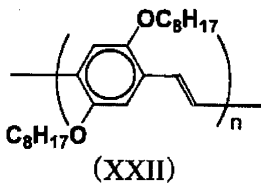
버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 상기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 8>

버퍼층 형성용의 가수분해성기를 함유하는 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 상기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 4와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 9>

발광 재료로서 발광성 고분자[하기 화합물(XXII), 폴리파라페닐렌비닐렌(PPV)계, $M_w \approx 10^5$]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 발광층을 형성한 이외는, 실시예 1과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.



<실시예 10>

발광 재료로서 발광성 고분자[화합물(XXII), PPV계, $M_w \approx 10^5$]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 정공 수송층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 발광층을 형성한 이외는, 실시예 2와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 11>

발광 재료로서 발광성 고분자[화합물(XXII), PPV계, $M_w \approx 10^5$]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 정공 수송층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 발광층을 형성한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 12>

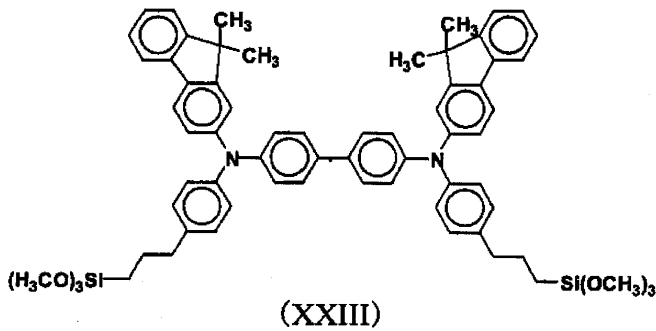
정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIV-2)($M_w = 9.45 \times 10^4$)] 0.5중량부와, 발광 재료로서 발광성 고분자[화합물(XXII), PPV계, $M_w \approx 10^5$] 0.1중량부를 혼합하고, 이들의 혼합물을 10중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1 μ m의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과함으로써 발광층 형성용 용액을 제조했다.

이 용액을 사용하여, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 50nm의 전하 수송층을 갖는 발광층을 형성한 이외는, 실시예 4와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<실시예 13>

버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료로서 상기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

- <302> <실시에 14>
- <303> 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.
- <304> <실시에 15>
- <305> 실시예 1과 마찬가지로, 세정한 ITO 전극 부착 유리 기판 위에, 상기 구조식 (XIX)[이온화 퍼텐셜 = 5.0eV]로 표시되는 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료에 의해 버퍼층을 형성한 후, 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성했다.
- <306> 충분히 건조시킨 후, 발광 재료로서 승화 정제한 Alq₃(화합물(IX-1))을 텅스텐 보트에 넣고, 진공 증착법에 의해 증착하여, 정공 수송층 위에 막두께 50nm의 발광층을 형성했다. 이때의 진공도는 10⁻⁵Torr, 보트 온도는 300℃이었다.
- <307> 마지막으로, Mg-Ag 합금을 공증착에 의해 증착하여, 2mm 폭, 150nm 두께의 배면 전극을 ITO 전극과 교차하도록 형성했다. 형성된 유기 EL 소자의 유효 면적은 0.04cm²이었다.
- <308> <실시에 16>
- <309> 버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료로서 상기 구조식 (XXI)[이온화 퍼텐셜 = 5.4eV]로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 14와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.
- <310> <실시에 17>
- <311> 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.
- <312> <실시에 18>
- <313> 정공 수송성 재료로서 상기 전하 수송성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터로 여과하여 얻어진 용액을, 버퍼층 위에 스핀 코팅법에 의해 도포하여 막두께 30nm의 정공 수송층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.
- <314> <실시에 19>
- <315> 버퍼층 형성용의 치환 규소기를 갖는 전하 주입 재료로서 하기 구조식 (XXIII)[이온화 퍼텐셜 = 5.1eV]으로 표시되는 재료를 사용하고, 전하 수송 재료 500mg과 염산(1N) 2mg을 부탄올 1ml에 용해하여 제조한 용액을 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 120℃에서 1시간 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 1과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.



<316>

<317>

<비교예 1>

<318>

ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료를 사용하여 버퍼층을 형성하지 않고, 직접 발광층부터 형성한 이외는, 실시예 1과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<319>

<비교예 2>

<320>

ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료를 사용하여 버퍼층을 형성하지 않고, 직접 정공 수송층부터 형성한 이외는, 실시예 2와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<321>

<비교예 3>

<322>

ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료를 사용하여 버퍼층을 형성하지 않고, 직접 정공 수송층부터 형성한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<323>

<비교예 4>

<324>

ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료를 사용하여 버퍼층을 형성하지 않고, 직접 발광층부터 형성한 이외는, 실시예 4와 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<325>

<비교예 5>

<326>

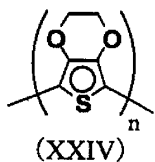
ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 치환 규소기를 갖는 전하 수송 재료를 사용하여 버퍼층을 형성하지 않고, 직접 정공 수송층부터 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<327>

<비교예 6>

<328>

버퍼층 형성용의 전하 주입 재료로서, 바이트론(Baytron) P(PEDOT·PSS, 마이엘 주식회사제; 폴리에틸렌 디옥사이드 티오펜[하기 화합물(XXIV), 이온화 퍼텐셜 = 5.1~5.2eV]과 폴리스티렌설포산을 함유하는 혼합 수분산액)를 사용하고, 이 용액을, 세정 후 건조시킨 ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 스핀 코팅법에 의해 도포하고, 200℃에서 10분 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.



<329>

<330>

<비교예 7>

<331>

버퍼층 형성용의 전하 주입 재료로서, 바이트론(Baytron) P(PEDOT·PSS, 마이엘 주식회사제; 폴리에틸렌 디옥사이드 티오펜[상기 화합물(XXIV), 이온화 퍼텐셜 = 5.1~5.2eV]과 폴리스티렌설포산을 함유하는 혼합 수분산액)을 사용하고, 이 용액을, 세정 후 건조시킨 ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 층의 면 위에, 스핀

코팅법에 의해 도포하고, 200℃에서 10분 가열 경화함으로써 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<332> <비교예 8>

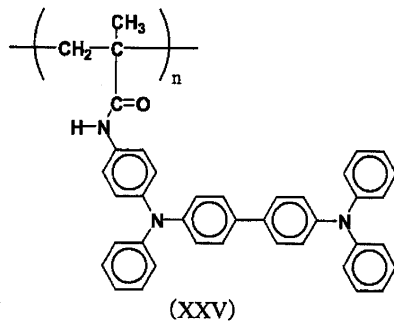
<333> 버퍼층 형성용의 전하 주입 재료로서, 저분자계 주입 재료 : 스타버스트계[상기 화합물(VIII-5), MTDATA(4,4',4"-트리스(3-메틸페닐페닐아미노)트리페닐아민), 이온화 퍼텐셜 = 5.1eV]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1μm의 PTFE 필터로 여과함으로써 제조한 용액을 사용하고, 이 용액을, 세정 후 건조시킨 ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 측의 면 위에, 스핀 코팅법에 의해 도포하여 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

<334> <비교예 9>

<335> 버퍼층 형성용의 전하 주입 재료로서, 저분자계 주입 재료 : 스타버스트계[상기 화합물(VIII-5), MTDATA, 이온화 퍼텐셜 = 5.1eV]를 5중량% 용해시킨 클로로벤젠 용액을 구멍 크기 0.1μm의 PTFE 필터로 여과함으로써 제조한 용액을 사용하고, 이 용액을, 세정 후 건조시킨 ITO 전극 부착 유리 기판의 ITO 전극이 마련된 측의 면 위에, 스핀 코팅법에 의해 도포하여 충분히 건조시킨 후, 막두께 10nm의 버퍼층을 형성한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 유기 EL 소자를 제작했다.

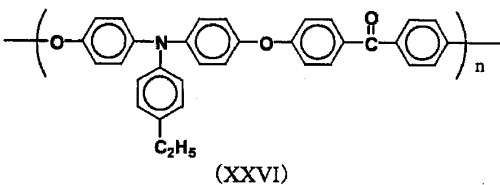
<336> <비교예 10>

<337> 정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)] 대신에, 비닐 골격을 갖는 전하 수송성 고분자 [하기 화합물(XXV), Mw = 5.46×10⁴(스티렌 환산)]을 사용한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 소자를 제작했다.



<338> <비교예 11>

<340> 정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)] 대신에, 폴리카르보네이트 골격을 갖는 전하 수송성 고분자[하기 화합물(XXVI), Mw = 7.83×10⁴(스티렌 환산)]를 사용한 이외는, 실시예 3과 마찬가지로 소자를 제작했다.



<342> <비교예 12>

<343> 정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)] 대신에, 비닐 골격을 갖는 전하 수송성 고분자 [상기 화합물(XXV), Mw = 5.46×10⁴(스티렌 환산)]를 사용한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으로 소자를 제작했다.

<344> <비교예 13>

<345> 정공 수송성 재료로서 전하 수송성 폴리에테르[화합물(XIII-2)] 대신에, 폴리카르보네이트 골격을 갖는 전하 수송성 고분자[상기 화합물(XXVI), Mw = 7.83×10⁴(스티렌 환산)]를 사용한 이외는, 실시예 11과 마찬가지로 방법으

로 소자를 제작했다.

(평가)

이상과 같이 제작한 유기 EL 소자를 진공 중($133.3 \times 10^{-3} \text{ Pa} (10^{-5} \text{ Torr})$)에서 ITO 전극 측을 양극, Mg-Ag 배면 전극을 음극으로 하여 직류 전압을 인가하여 발광시켰을 때의 시동 전압(구동 전압), 최고 휘도, 및 최고 휘도 시의 구동 전류 밀도를 평가했다. 그들의 결과를 표 3에 나타낸다.

또한, 건조 질소 중에서 유기 EL 소자의 소자 수명의 측정을 행했다. 소자 수명의 평가는 초기 휘도가 50 cd/m^2 가 되도록 전류값을 설정하고, 정전류 구동에 의해 휘도가 초기값으로부터 반감할 때까지의 시간을 소자 수명(hour)으로 했다. 이때의 소자 수명도 표 3에 나타낸다.

<표 3>

	시동 전압 (V)	최고 휘도 (cd/m^2)	구동 전류 밀도 (mA/cm^2)	소자 수명 (hour)
실시예 1	2.3	8,300	285	48
실시예 2	2.1	11,700	355	61
실시예 3	2.4	10,500	320	60
실시예 4	3.2	5,600	240	43
실시예 5	3.7	7,500	280	45
실시예 6	2.0	12,000	345	63
실시예 7	1.9	10,500	330	73
실시예 8	3.4	7,400	290	49
실시예 9	2.2	9,500	295	55
실시예 10	2.0	13,400	350	64
실시예 11	1.8	11,500	310	63
실시예 12	3.7	6,400	260	43
실시예 13	2.2	11,400	290	62
실시예 14	1.9	10,700	300	59
실시예 15	2.0	9,300	290	51
실시예 16	2.4	12000	310	55
실시예 17	2.3	9800	280	64
실시예 18	2.5	10500	300	58
실시예 19	2.4	8800	290	46
비교예 1	5.5	5,900	180	29
비교예 2	6.1	4,200	140	21
비교예 3	5.7	3,630	170	15
비교예 4	4.5	4,000	150	19
비교예 5	4.8	5,600	80	25
비교예 6	2.3	10,020	310	39
비교예 7	2.4	9,200	300	40
비교예 8	2.8	7,700	290	25
비교예 9	2.9	8,400	315	23
비교예 10	2.8	4,700	300	38
비교예 11	2.9	4,400	255	25
비교예 12	2.5	6,000	300	20
비교예 13	2.9	5,400	270	24

표 3에서 알 수 있는 바와 같이, 실시예 1~19에 나타난 유기 EL 소자는, 전하 주입 재료가 가수분해성기를 함유하는 치환 규소기를 갖는 것을 특징으로 하는 재료로 구성되어, 경화하여 인접층으로 블리딩하지 않고 양극(ITO 전극)과의 밀착성이 뛰어나고 또한 전하 주입성이 뛰어난 버퍼층을 형성함으로써 전하의 주입성이나 전하 밸런스가 개선되어, 버퍼층을 마련하지 않은 비교예 1~5의 유기 EL 소자보다도 보다 안정적이며 고휘도, 고효율 특성을 나타냄을 알 수 있었다.

또한, 실시예 3 및 11과, 비교예 6~9의 비교로부터 알 수 있는 바와 같이, 블리딩의 원인이 되는 저분자 성분을 함유할 가능성이 있는 버퍼층으로 치환한 경우에도, 버퍼층으로서 본 실시 형태에서 사용되는 전하 주입 재

료를 사용한 실시예 3 및 11 쪽이 소자 수명이 뛰어남을 알 수 있었다.

<353> 또한, 실시예 3 및 11과, 비교예 10~13의 비교로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 실시 형태에서 사용되는 전하 수송성 폴리메테르를 사용한 실시예 3 및 11 쪽이, 보다 소자 수명이나 발광 휘도가 뛰어남을 알 수 있었다. 이것은 버퍼층과의 밀착성이나 전하 수송성이 본 실시 형태에 있어서의 전하 수송성 폴리메테르의 사용에 의해 향상되었기 때문이라고 생각된다.

<354> 더하여, 어느 실시예에서도 성막 시의 핀홀이나 박리 결함도 발생하지 않음을 알 수 있었다. 또한, 그 제작 시에 스핀 코팅법이나 디핑법 등을 이용하여 양호한 박막을 형성할 수 있기 때문에, 핀홀 등의 불량도 적고, 대면 적화가 용이하며, 뛰어난 내구성과 발광 특성을 얻을 수 있음을 알 수 있었다.

도면의 간단한 설명

<355> 도 1은 본 실시 형태에 따른 표시 장치의 층 구성의 일례를 나타낸 모식적인 단면도.

<356> 도 2는 본 실시 형태에 따른 표시 장치의 층 구성의 일례를 나타낸 모식적인 단면도.

<357> 도 3은 본 실시 형태에 따른 표시 장치의 층 구성의 일례를 나타낸 모식적인 단면도.

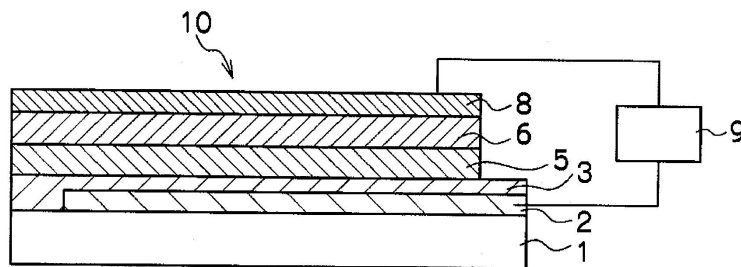
<358> 도 4는 본 실시 형태에 따른 표시 장치의 층 구성의 일례를 나타낸 모식적인 단면도.

<359> 도면의 주요 부호에 대한 설명

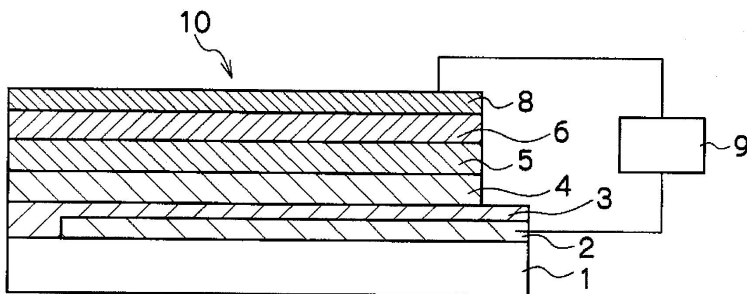
<360> 1...투명 절연체 기판, 2...투명 전극, 3...버퍼층, 4...정공 수송층, 5...발광층, 6...전자 수송층, 7...전하 수송능을 갖는 발광층, 8...배면 전극, 9...전압 인가 장치, 10...유기 전계발광 소자

도면

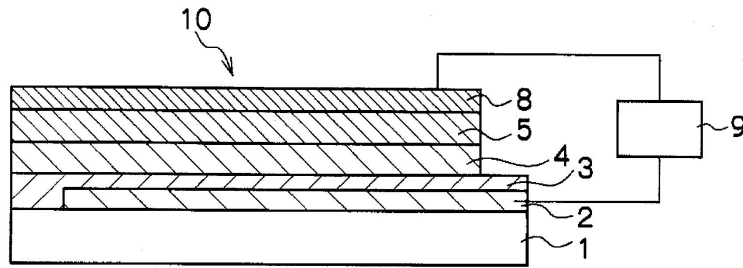
도면1



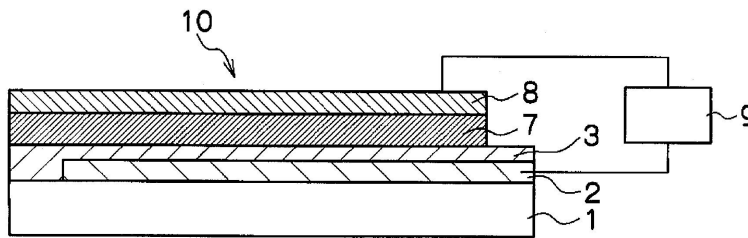
도면2



도면3



도면4



专利名称(译)	有机电致发光器件和显示器件		
公开(公告)号	KR1020080109594A	公开(公告)日	2008-12-17
申请号	KR1020080022787	申请日	2008-03-12
[标]申请(专利权)人(译)	富士施乐株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士jerot sikki库斯有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	富士jerot sikki库斯有限公司		
[标]发明人	OKUDA DAISUKE 오쿠다다이스케 SATO KATSUHIRO 사토가츠히로 NISHINO YOHEI 니시노요헤이 HORIBA KOJI 호리바고지 MASHIMO KIYOKAZU 마시모기요카즈 AGATA TAKESHI 아가타다케시 ISHII TORU 이시이도루 IMAI AKIRA 이마이아키라 OZAKI TADAYOSHI 오자키다다요시 HIROSE HIDEKAZU 히로세히데카즈 YONEYAMA HIROHITO 요네야마히로히토 SEKI MIEKO 세키미에코		
发明人	오쿠다다이스케 사토가츠히로 니시노요헤이 호리바고지 마시모기요카즈 아가타다케시 이시이도루 이마이아키라 오자키다다요시 히로세히데카즈 요네야마히로히토 세키미에코		
IPC分类号	H01L51/54		
CPC分类号	H01L51/0038 H01L51/5048 H01L51/0039 H01L51/0094 H01L51/0035 H01L51/0081 H01L51/5088		
代理人(译)	MOON , KI桑		

摘要(译)

本发明中，一个透明的或一对透光性正极和负极中的至少一个，并夹在正和负电极的电极之间的有机化合物层，由所述有机化合物层，所述缓冲层和所述发光层的成两层或更多层包括至少提供一种有机电致发光器件。至少一层有机化合物层含有至少一种特定的电荷传输聚醚。缓冲层与阳极接触的方式设置，还含有交联化合物是使用具有硅的特定的取代的电荷注入材料的至少一种形成。此外，基板，以及多个在所述衬底上的矩阵布置的有机发光元件，其具有驱动装置的显示装置是指用于驱动有机电致发光设备，即有机电致发光装置中，各有机EL器件的提供。

